

M3TEK

2024

來頡科技股份有限公司 永續報告書
M3 Technology Inc.



經營者的話	3		
關於本報告	4		
1 關於來頡科技	5	4 其他治理議題	47
1-1 公司簡介	5	4-1 公司治理	47
1-2 產品簡介	8	4-2 稅務治理	53
1-3 營運概況	11	4-3 誠信經營	54
		4-4 創新管理	55
2 永續議題管理	14	4-5 資安管理	58
2-1 鑑別重要利害關係人	14	4-6 客戶服務	61
2-2 重要利害關係人議合	15		
2-3 重大性鑑別與分析	16	5 其他環境與社會議題	65
2-4 永續議題管理方針	23	5-1 環境政策	65
		5-2 人員發展	66
3 SASB 關注議題	29	5-3 人權與員工關係	68
3-1 溫室氣體排放	29		
3-2 能源管理	30	6 附錄	69
3-3 水資源管理	31	6-1 GRI 索引表	69
3-4 廢棄物管理	32	6-2 SASB 索引表	73
3-5 員工健康與安全	33	6-3 永續揭露指標 - 半導體業	75
3-6 招募及管理全球專業人才	34	6-4 溫室氣體盤查及確信情形	76
3-7 產品生命週期管理	41	6-5 數據揭露範疇	77
3-8 原物料採購	42		
3-9 智慧財產權保護與競爭行為	45		

經營者的話

來頡科技自成立以來逾十五年，歷經全球政治和經濟局勢變動，包含中美貿易、俄烏戰爭、生成式 AI 發展，到 2025 年川普新政策等充滿機遇與挑戰，來頡科技持續應對變化，尋求創新突破，穩健前行。

近年隨著 Wi-Fi 7、AIoT 及 AI PC 等新興應用的快速發展，帶動電源管理晶片 (PMIC) 市場成長，來頡科技專注於 PMIC 技術研發，並持續提升先進 BCD (Bipolar-CMOS-DMOS) 製程技術，不斷推出創新產品。2024 年，我們的超低待機功耗降壓轉換器 MT8351 產品榮獲「亞洲金選獎」(EE Product Awards)，顯現技術創新能力備受肯定。我們持續積極開發高性能、低功耗的 PMIC 新產品，提高終端產品的能源使用效率，有助於減少整體能源消耗與碳排放。

來頡科技 2025 年發布「來頡科技 2024 年永續報告書」係展現永續發展承諾的第一步，作為未來致力於投入改善與成長的基礎，亦持續於公司治理、環境與社會面向努力，期盼帶來正向影響力。

公司治理：

我們秉持誠信尊重、創新思維、團隊合作、品質提升及服務客戶五大原則，致力於維持營運透明、保障股東權益。我們將持續從上而下推動並深化公司治理機制，確保所有決策皆以長期價值為核心導向。

環境：

環境方面，我們考量現行鋰電池所造成的環境議題，設計了一系列專為超級電容充電器設計的產品，可以搭配超級電容的特性來取代鋰電池的部分應用，有助於降低環境衝擊。

除了產品設計與研發考量永續面向外，2025 年，我們首次展開 2024 年組織型溫室氣體盤查，掌握碳排放情形，並規劃未來可行之減碳方案，以響應全球淨零碳排放趨勢，共同為減緩氣候變遷努力。

社會：

我們致力於營造友善且包容的職場環境，持續推動多元、平等與共融的企業文化，讓每位員工都能感受到尊重與重視。此外，我們將持續以員工福祉為核心，積極履行社會責任，確保企業經營對社會發展產生正向影響。

展望未來：

來頡科技秉持永續經營理念，在鞏固既有市場優勢的同時，深化技術創新與研發投入，積極拓展新領域與商機，提升產業競爭力。我們將永續發展深度融入公司經營管理策略，確保於變動的環境下保持企業韌性與穩健成長。

董事長：陳文良
執行長：葉瑞斌
總經理：孟慶達

關於本報告

來頡科技股份有限公司 (以下簡稱為「來頡科技」、「來頡」、「我們」、「**M3TEK**」)
2024 年永續報告書 (以下簡稱為「本報告書」) 編製資訊如下：

聯絡資訊

對於本報告書有任何疑問，歡迎透過下列方式與我們聯絡。

聯繫窗口 | 公司治理主管，張瑜恬

公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路 358 巷 38
弄 36 號 9 樓

公司電話 | 02-2656-0961

電子郵件 | donachang@m3tekic.com

揭露依據

依循標準：

GRI 永續報告準則 2021 年版 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards 2021)

AA1000 當責性原則 (AA1000 AccountAbility Principles, AA1000 V3)

永續會計準則 (SASB)：科技與通訊 (Technology and Communications)

領域之半導體 (Semiconductors) 產業之 SASB 標準 (2023 年 12 月版)

報導期間

時間範疇：

本報告書自 2025 年首度發行 2024 年報告書

本次報導期間：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 止 (與財務報告報導期間相同)

本次中文版發行日期：2025 年 8 月底前

未來發行頻率：每年 1 次

揭露範疇

本次報告書為首次發行，揭露來頡科技台灣於永續面向之執行績效。未來將逐年完整涵蓋合併財務報表下之所有實體 (中國大陸及美國等地之子公司)。另亦可參考「6-5 數據揭露範疇」詳列資訊揭露範圍。

揭露說明

財務績效：

財務數據係由勤業眾信聯合會計師事務所會計師簽證之財務報告資訊為準，財務相關揭露之幣別為新台幣。

非財務績效：

報告書內其他相關數據為來頡科技自行統計近 3 年數據，以一般慣用數值描述方式，採四捨五入為原則。惟考量部分績效資訊之收集時點不足 3 年或其正確性無法詳實佐證，除財務數據揭露近 4 年數據外，環境與人力數據，分別揭露 1 年與 1-3 年數據。

編製流程

本報告書所揭露之數據或資料，係由各權責部門提供經報告書小組進行報告書編製作業，完成之報告書送交各部門主管確認無誤後，執行長審閱後，董事會核准通過，完成內部審查之程序，且公開於來頡科技官網。

1-1 公司簡介

來頡科技成立於 2010 年，主要從事類比 (Analog) 暨混合訊號 (Mixed-signal) 積體電路 (IC) 設計、測試、生產及行銷等業務。核心業務為電源管理 IC 設計與銷售，提供高效率、電感少、電壓穩定、低干擾的電源管理 IC 晶片解決方案，確保電子設備系統的電能轉換、分配、檢測及系統的穩定性。

優勢與發展

來頡科技有經驗豐富且高度專業的研發團隊，於 DC-DC (直流轉換成直流) 電源及多功能 (Multi-function) 高集成 IC，獲得多項國際專利認證，來頡透過成本優化與多元化及高度整合的系統方案，提供具高性價比的產品，獲得國際型客戶採用。

針對資通訊領域已與網通 ODM 廠及品牌商、電信營運商等客戶群緊密合作，在網路蓬勃發展傳輸速率大為提升的通訊時代，將為後續業績挹注大幅成長的動能。

消費性領域如 SSD，已拓展許多新項目之設計，配合國內外主控晶片廠商開發一系列的電源管理晶片，因應市場需求及技術演進提供客戶全方位解決方案，透過與各主晶片廠的聯合開發，導入高集成電源管理及電源保護晶片，開發符合客戶需求及更具競爭力之產品，提升客戶產品的附加價值。

同時，藉由產品線的相輔相成，一次滿足客戶對電源類比相關 IC 的需求，亦可節省客戶採購資源，並強化與客戶的關係，進而擴大至其他相關的應用產品面。來頡科技持續透過技術創新、產品優化、市場拓展，鞏固競爭優勢，推動企業成長。

公司名稱	來頡科技股份有限公司
股票代號	6799
董 事 長	愛普科技股份有限公司 (法人代表：陳文良)
成立時間	2010 年 9 月 7 日
上市時間	2022 年 5 月 12 日
營運總部	台灣
營運據點	台北市、新竹縣
銷售服務	電源管理 IC 研發設計與銷售
產 品 線	資訊通訊類產品、消費性及其他產品
資 本 額	新臺幣 4.3 億元 (截至 2024 年底)
員工人數	來頡集團 94 人 來頡科技 47 人 (截至 2024 年底)
營收規模	新臺幣 9.07 億元 (2024 年度合併營收)

願景與使命

願景

「透過 **M3TEK** 經營團隊的持續努力，讓 **M3TEK** 成為客戶首選電源管理方案供應商」

使命

◆ 強化客戶體驗

M3TEK 以持續提供客戶創新、可靠、高效率及高 CP 值的產品為使命，藉以增強客戶信賴度及其產品的競爭力。

◆ 持續研發投入

持續投入大量研發資源，持續挑戰及研究新技術，開發更高規格的产品。

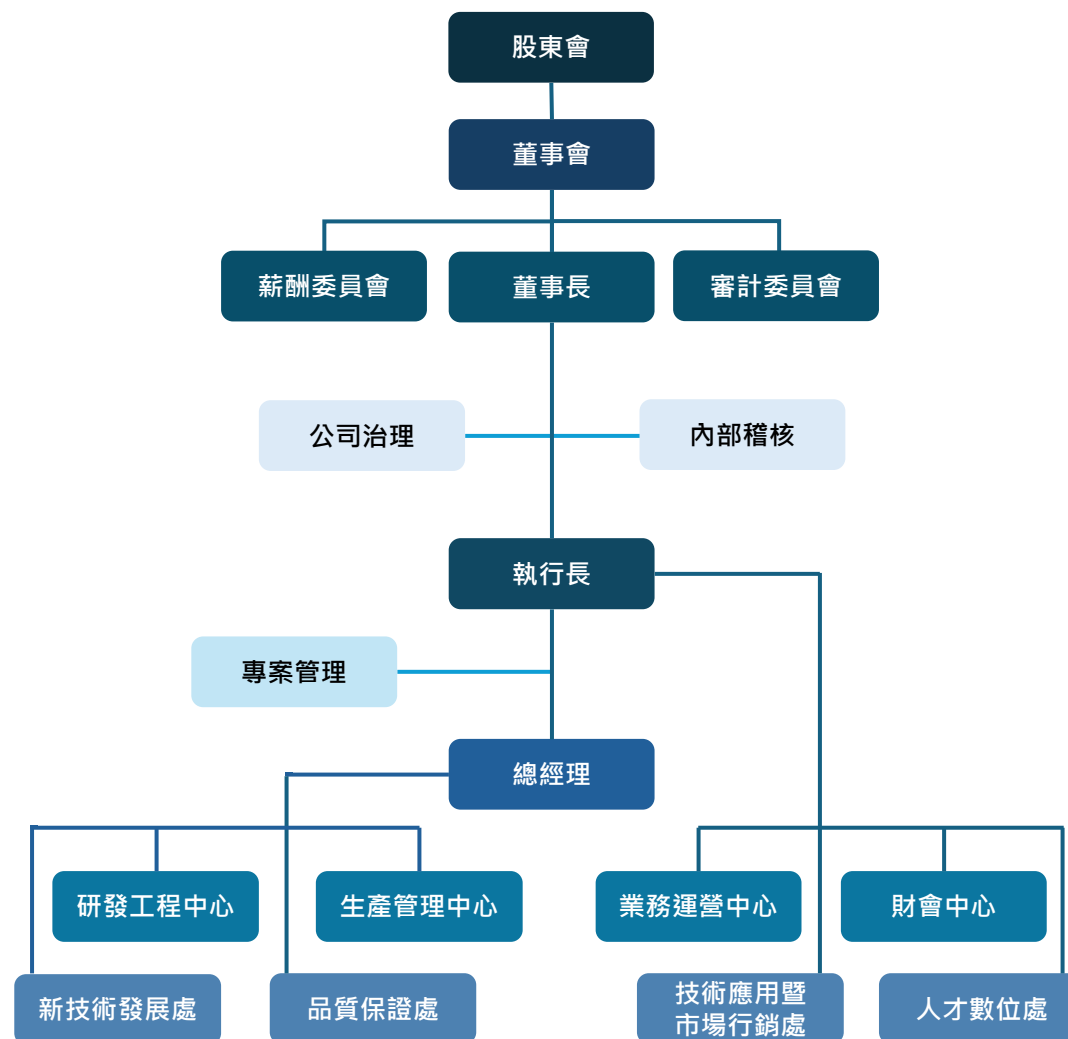
◆ 加速新產品開發

5G+WiFi 6 提供了遠程醫療、遠程教學和遠程辦公可行性。透過 **M3TEK** 產品的創新，協助我們客戶去實現遠程應用，並降低碳排放量、減緩全球暖化。

◆ 隨時做好準備

產業環境及終端消費市場因受到外在刺激，需求瞬息萬變，**M3TEK** 開發具高規格、可靠性高、低功耗之產品以因應產業之變化。

組織架構



公司沿革

年度	開發成功之技術或產品
2024 年	• 推出 5V/3A/1.4MHZ 超小型封裝 DFN 1.5x1.5_6L 同步降壓轉換器。 • 推出 24V/3A/1.4MHz 高頻切換同步降壓轉換器。 • 推出 24V/3A/700KHz 高效率同步降壓轉換器。 • 推出 33V/6A/700KHz 超小型封裝 QFN2X3_12L 同步降壓轉換器。 • 推出高效能 5A 負載開關超小型封裝 DFN1.5x1.5_6L。 • 推出高效能兩節鋰電池 2A 升壓充電並集成反向降壓放電管理 IC。 • 推出 33V/5A 高集成 I2C 數字控制負載開關適用於 USB PD 應用。 • 推出超小型集成電感 5.5V/3A/2.2MHz 同步降壓轉換器 QFN2.5x3.5。 • 推出首款超低功耗 350nA,5V/1A/1.5MHz 同步降壓轉換器。 • 推出 5.5V/4A 高效能集成防止 28V 反逆灌保護負載開關。 • 推出高集成 5V/1A/2MHz 同步升降壓轉換器。 • 推出 5V/3A (4A Peak) /1.25MHz/SOT563 封裝同步降壓轉換器。 • 推出 5V/5A/1.2MHz/SOT583 封裝同步降壓轉換器。 • 推出 33V/6A 多功能 I2C 數字控制同步降壓轉換器。

※ 更多來頡科技公司沿革，詳見[公司官網](#)。

2023 年

- 推出超小型封裝 DFN 1.5x1.0_5L 支持 3A 輸出電流降壓轉換器。
- 推出低電壓高電流 5A 降壓轉換器 QFN3X3_16。
- 推出低電壓高電流 6A 降壓轉換器 QFN2X2_12。
- 推出 28V/6A/500KHz 高集成升壓 - 降壓轉換器 QFN5X5-28 封裝。
- 推出 28V/6A/200KHz 高集成升壓 - 降壓轉換器 QFN5X5-28 封裝。
- 推出低電壓 6A/2.2MHz 快速響應同步降壓轉換器。
- 推出寬電壓 28V/6A 升壓 - 降壓控制器。
- 推出支援 DDRII~IV 3A 電流調節轉換器。
- 推出雙向電流開關及過電壓保護的 21V/6A 負載開關驅動器。
- 推出低電壓 1.2MHz 輸出電流 6A/10A 快速響應同步降壓轉換器。
- 推出 28V/8A 可調頻率 200K~1.2MHz 同步降壓轉換器。
- 推出 18V/8A/700KHz 高集成 QFN3*3_16 同步降壓轉換器。

2022 年

- 推出先進製程低電壓高頻率 2.5MHz 切換式降壓 IC。
- 推出超小型封裝 DFN1.5*1.5 高頻率切換式降壓 IC。
- 發佈高精度充放電及內建平衡的超級電容電源管理 IC。
- 推出 18V 高壓 1.5MHz 高頻率小封裝 SOT563 切換式降壓 IC。
- 推出超小型封裝 SOT-563、高頻率 2.5MHz 切換式降壓 IC。
- 推出高耐壓 28V 過電流過電壓，可調整電流限 DFN2*2 封裝負載開關 IC。
- 推出寬電壓輸入、過電壓過電流、防逆電壓功率管控制器的大電流負載開關。
- 發佈高耐壓支持單節 / 雙節高精度充放電及內建平衡的超級電容電源管理 IC。
- 推出高耐壓 26V/5A，200KHz/500KHz 自帶可調整限電流同步降壓轉換器。
- 推出 18V 耐壓具外接反向功率管控制器的大電流負載開關器。
- 推出單輸入雙輸出低壓 2A、高頻率 2.5MHz、小尺寸降壓轉換器。
- 推出高耐壓 28V 小封裝 DFN2*2。

1-2 產品簡介

產品與應用

來頡科技專注於高階電源管理 IC 的研發與創新，致力於提供高效率、低功耗、電壓穩定且低電磁干擾（EMI）的電源解決方案，具備高度系統整合設計能力。產品廣泛應用於資訊、通訊及消費性電子等領域。

隨著 Wi-Fi 7、5G 通訊、雲端運算、高速儲存系統以及 USB Type-C 等先進技術快速發展，市場對高規格與高整合度電源管理 IC 的需求日益提升。來頡科技積極回應這些趨勢，持續投入創新研發，以滿足新世代電子產品在效能與能源效率上的嚴苛要求。

我們以客戶服務為核心，專注於資通訊與消費性電子應用領域的類比電源管理 IC 開發。透過客製化、高整合度、高效率與高可靠度的解決方案，我們不僅能快速響應市場需求，更與客戶建立長期策略合作關係，攜手提供最具競爭力的電源管理解決方案。

SASB 營運活動指標

指標編號	指標編號	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
TC-SC-000.A	產品總生產量 - 電源管理晶片 (單位：仟個)	450,361	378,737	391,108	355,287
TC-SC-000.B	從自有廠區生產的百分比 註	0	0	0	0

註：來頡為無廠晶片設計公司，並無生產線等大型廠房，主要負責晶片研發、設計與銷售，無生產製造階段，該指標數據為 0。

指標編號	特性	說明	應用領域
降壓轉換器 (Buck Converter)	- 快速瞬態響應 - 低紋波 - 低靜態電流 - 高效率轉換 - 高頻率切換減少周邊器件	- M3TEK 的降壓轉換器系列融合最新電源管理技術，提供高效率、低功耗的解決方案，適用於各類電子設備。 - 透過內建高效金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 與先進的控制架構，實現超高速瞬態響應、極低紋波與低 EMI (電磁干擾) 特性。此外，低靜態電流 (Iq) 設計可確保裝置在待機模式下的極低功耗，延長電池續航力。 - M3TEK 憑藉高整合度與易用性，此系列產品廣泛應用於物聯網 (IoT) 、智慧醫療、工業自動化、儲能系統、通訊設備、SSD 存儲裝置及新世代車載電子等領域。	Telecom/Datacom、IoT、NB、PC、TV、Monitor、Power system、Storage、SSD、Type-C
升壓與升降壓轉換器 (Boost/Buck-Boost Converter)	- 寬電壓 - 快速瞬態響應 - 低紋波 - 高集成	- M3TEK 提供高效升壓與升降壓轉換器，適用於高動態範圍應用，確保輸出電壓穩定，滿足新世代電子設備的多元需求。 - M3TEK 憑藉創新的控制技術，這些轉換器可提升整體電源效率，降低發熱，確保長期穩定運行。 - 升降壓轉換器則可在輸入電壓波動範圍內保持穩定輸出，適用於高功率密度電源設計、電池供電系統、智慧儲能裝置等。 - 升壓轉換器適用於低電壓轉高電壓應用，例如 USB Type-C PD (Power Delivery) 快充、無線通訊設備、便攜式醫療儀器等。	IoT、USB-PD、Power system、NB
高精度低壓差轉換器 (LDO)	- 低噪聲 - 低靜態電流 - 小封裝 (SOT23/SOP8-EP/DFN) - 高雜訊抑制能力 (PSRR)	- M3TEK 的新世代 LDO 採用超低噪聲架構與高雜訊抑制 (PSRR) 技術，確保在關鍵應用中提供穩定電源。具備超低靜態電流設計，能夠顯著降低功耗，延長電池使用壽命。 - 該系列產品採用 DFN/SOT23/SOP8-EP 等小型封裝，適用於高精度感測器、低功耗無線模組、智慧穿戴設備、電池供電系統等應用，確保高效能與極致穩定性。	Telecom/ Datacom、IoT、Solar-powered Instruments、Smart meter

主要產品	特性	說明	應用領域
智能負載開關 (Load Switch)	- 湧入電流限流 - 自動放電 - 缺電壓鎖定 - 過電壓保護 (OVP)、反向電流保護、過溫保護 (OTP) 和短路保護 - 小封裝 - 低靜態電流	- M3TEK 的智能負載開關具備動態功率管理與精準數位控制功能，提供全方位的電源保護與系統穩定性。內建湧入電流 (inrush current) 限流、自動放電、過壓 / 過溫 / 短路防護等機制，可有效提升系統可靠性。 - 高精度數位控制介面可進一步提升保護機制的靈活性，確保終端設備的安全性與效能最佳化。 - 低靜態電流設計與小尺寸封裝，特別適用於高功率密度電源設計、IoT 設備、電池供電裝置、汽車電子等應用。	Type-C、Monitor、NB、PC、TV、Smart Phone
充放電管理 IC (Charger IC)	- 快速充放電能力 - 恆電流 / 電壓運作 - 低靜態電流 - 欠壓 / 過壓保護 (UVP/OVP) - 小封裝 (SOP8-EP/DFN)	- M3TEK 的充放電管理 IC 採用先進快充演算法，支援高效恆電流 / 恆電壓充電模式，確保電池的最佳化充放電效率。內建低 IQ、過壓 / 欠壓保護 (OVP/UVP) 等機制，有效延長電池壽命並提升整體能源利用率。 - 此外，小型 DFN (Dual Flat No Lead Package) 封裝設計適用於鋰電池管理、超級電容應用、智慧型便攜設備、車載電子等多元場景，為新世代儲能與電源管理提供更可靠與高效的解決方案。	Handheld Industrial Equipment、Portable Computers

1-3 營運概況

財務績效

近年來地緣政治升溫、保護主義興起、科技脫鉤和供應鏈重組，來頡科技所處的產業歷經了深刻變革。2024 年來頡科技受惠於終端市場需求緩步好轉，下游客戶訂單規模有所提升，進而帶動廠商庫存狀況回到健康水位。但受限於終端市場需求改善有限，以及同業激烈的價格競爭壓力，給來頡科技營運成長帶來了巨大挑戰。

來頡科技 2024 年度合併營業收入為新台幣 907,178 仟元，較前一年度減少約 11.3%；營業利益為 139,781 仟元，年減約 46.9%；本期淨利為 121,558 仟元，淨利率 13.4%，每股盈餘為新台幣 2.94 元。來頡本著長期發展策略，維持穩定成長之精神，積極投入新產品研發和新市場開發，以因應產業結構之改變，市場及客戶端之需求，進而推動來頡後續成長。

2024 年資通訊類產品占整體營收比重約 79.2%、消費性電子產品占約 20.8%。目前主要市場為台灣、中國、以及韓國，並逐步拓展至歐洲及亞洲其他區域。

歷年營收與損益

單位：新台幣仟元

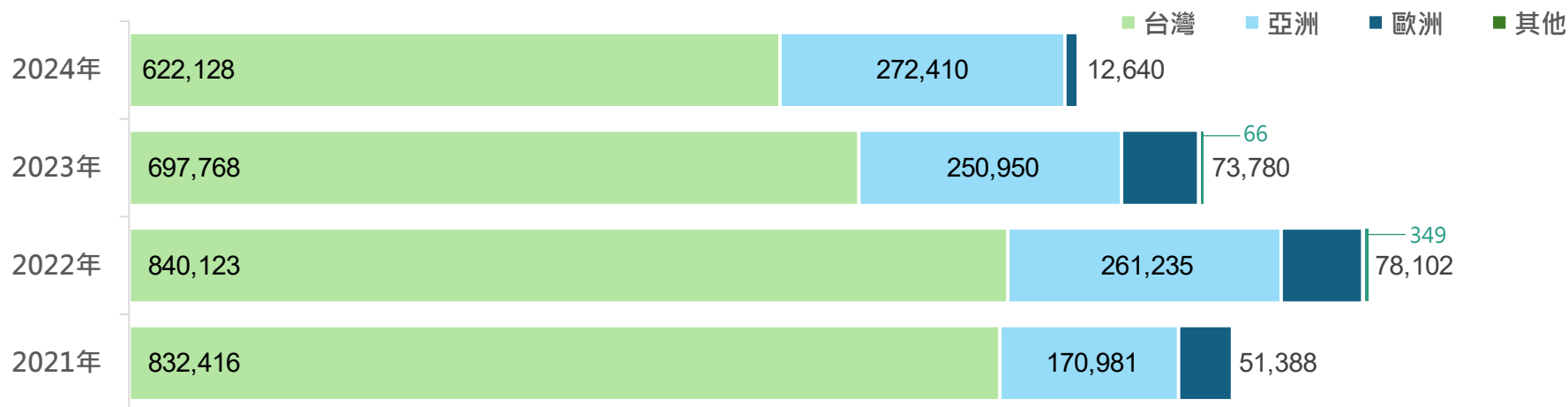
項目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
營業收入	1,054,785	1,179,809	1,022,564	907,178
營業成本	525,655	611,240	551,374	480,113
營業毛利	529,130	568,569	471,190	427,065
營業費用	179,691	214,866	207,787	287,284
推銷費用	46,872	57,891	44,263	50,067
管理費用	52,785	50,316	45,659	71,044
研究發展費用	80,034	106,659	117,865	166,173
預期信用減損損失	0	0	0	0
營業利益	349,439	353,703	263,403	139,781
營業外收入 (支出)	(-2,626)	19,911	8,829	52,024
稅前淨利	346,813	373,614	272,232	191,805
所得稅費用	70,863	77,595	53,756	70,247
本期淨利	275,950	296,019	218,476	121,558
其他綜合損益 (淨額)	148	(-416)	(-289)	413
本期綜合損益總額	276,098	295,603	218,187	121,971
基本每股盈餘 (元)	7.51	7.58	5.42	2.94

GRI 特定揭露支出項目

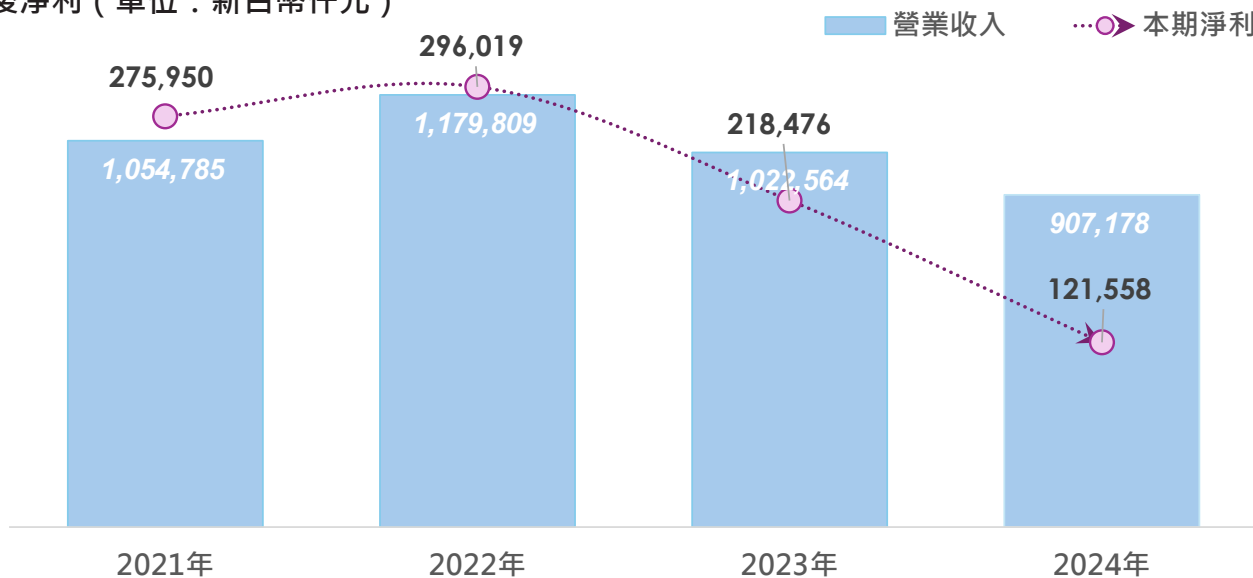
單位：新台幣仟元

項目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
政府補助金額	1,441	1,903	3,182	1,789
利息與股利支出	110,563	122,127	13,006	87,244
員工薪資與福利	155,588	179,921	154,880	236,895

◆ 歷年地區別營收金額 (單位：新台幣仟元)



◆ 歷年營收與稅後淨利 (單位：新台幣仟元)



股利政策

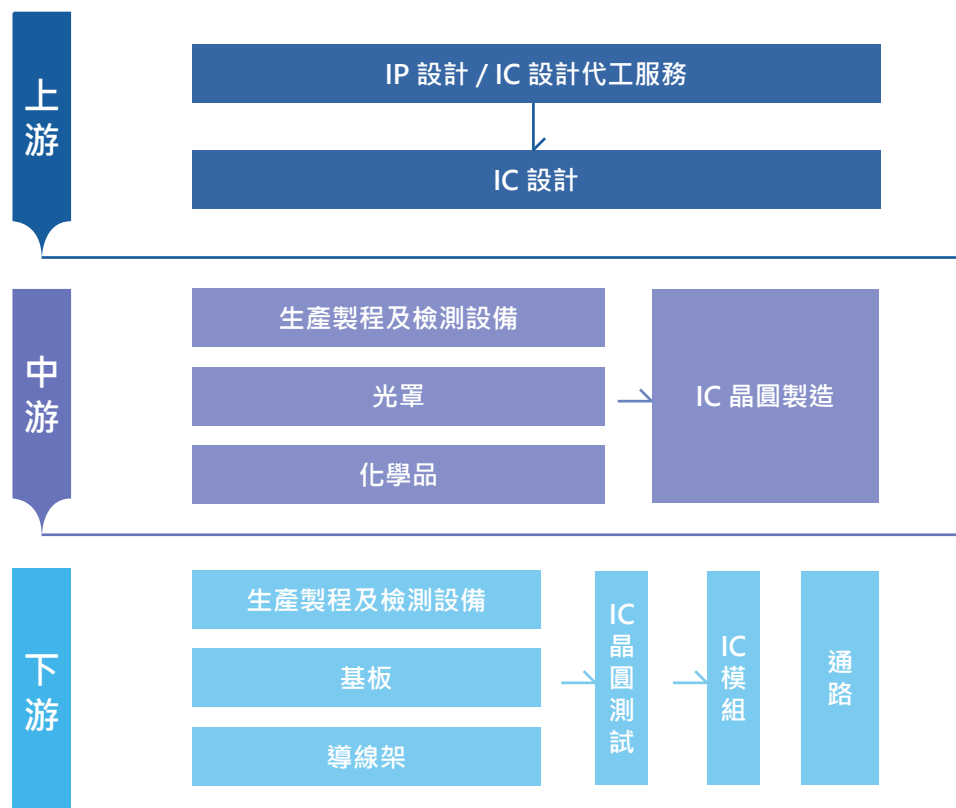
來頡科技依據公司章程規定，盈餘分派得於每季終了後為之，配合目前及未來之發展計畫，並參酌國內產業競爭狀況、投資環境及資金需求等因素，由董事會擬具分派議案，股利發放之數額得不低於當年度可供分配盈餘之百分之十五，得以股票股利或現金股利之方式為之，其中現金股利分派之比例不低於股利總額之百分之十。分派紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部份如以發放現金之方式為之，授權董事會以三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會；以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之。

歷年股利發放情形			
年度	2022 年	2023 年	2024 年
現金股利 (元)	3.05	3.05	2.00
分派率 (%)	40.24	56.27	68.03

價值鏈概況

台灣擁有全球最完整的半導體產業鏈及專業分工，來頡科技為高效能類比及混合訊號半導體 IC 設計公司，屬無晶圓廠 (Fabless)，歸類為半導體產業上游，晶圓代工、IC 製程、封裝及專業測試均屬中游與下游供應鏈。

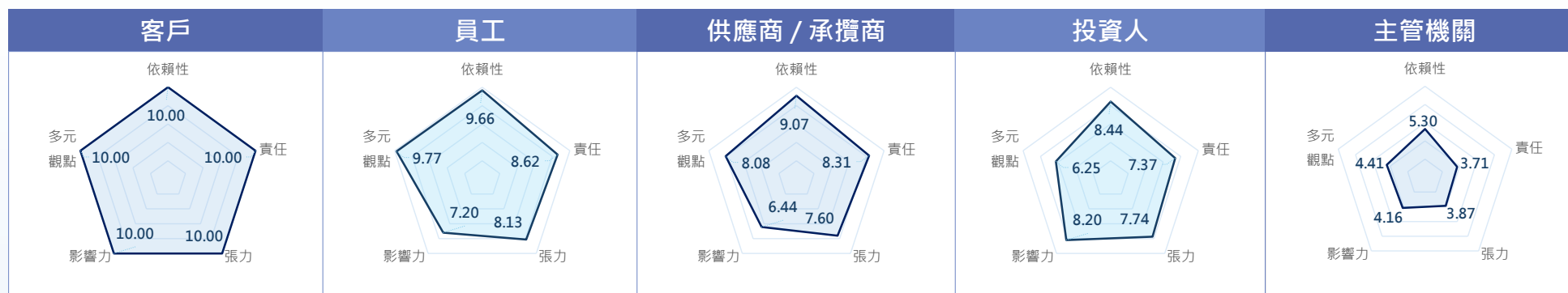
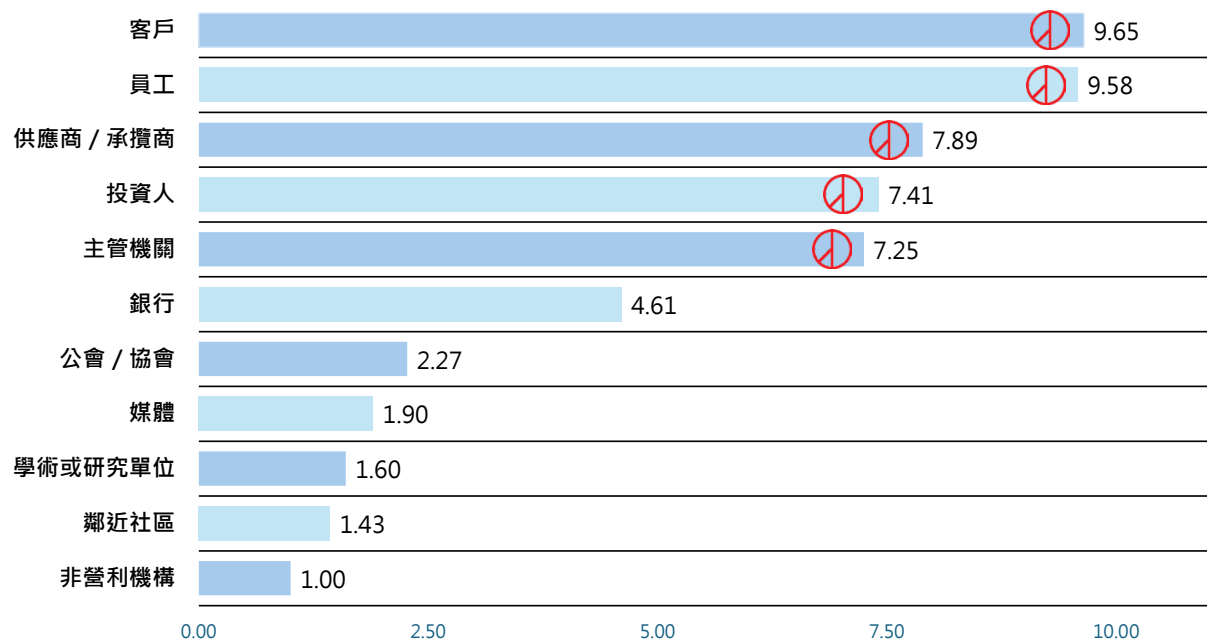
來頡科技於產品設計完成後，委由專業晶圓代工廠生產製造，再將產出之晶圓交由封裝廠進行封裝，並送至測試廠進行功能測試，測試後之成品經由代理商等銷售通路售予系統廠。



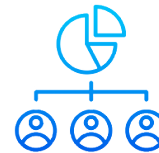
2-1 鑑別重要利害關係人

來頡科技透過在營運流程中與利害關係人互動，建立永續議題之溝通與回應機制，參考 AccountAbility 組織所制定的 AA1000 利害關係人議合標準 (AA1000 Stakeholder Engagement Standard, AA1000 SES) 之 5 大構面「責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性」，鑑別重要之利害關係人。

2024 年由來頡科技 13 位參與 ESG 專案之權責主管與負責人進行利害關係人評估，並經高階主管共同討論後，確認 5 類重要利害關係人，依序為客戶、員工、供應商 / 承攬商、投資人、主管機關等 5 類，其 5 項構面之評分結果分別如下。

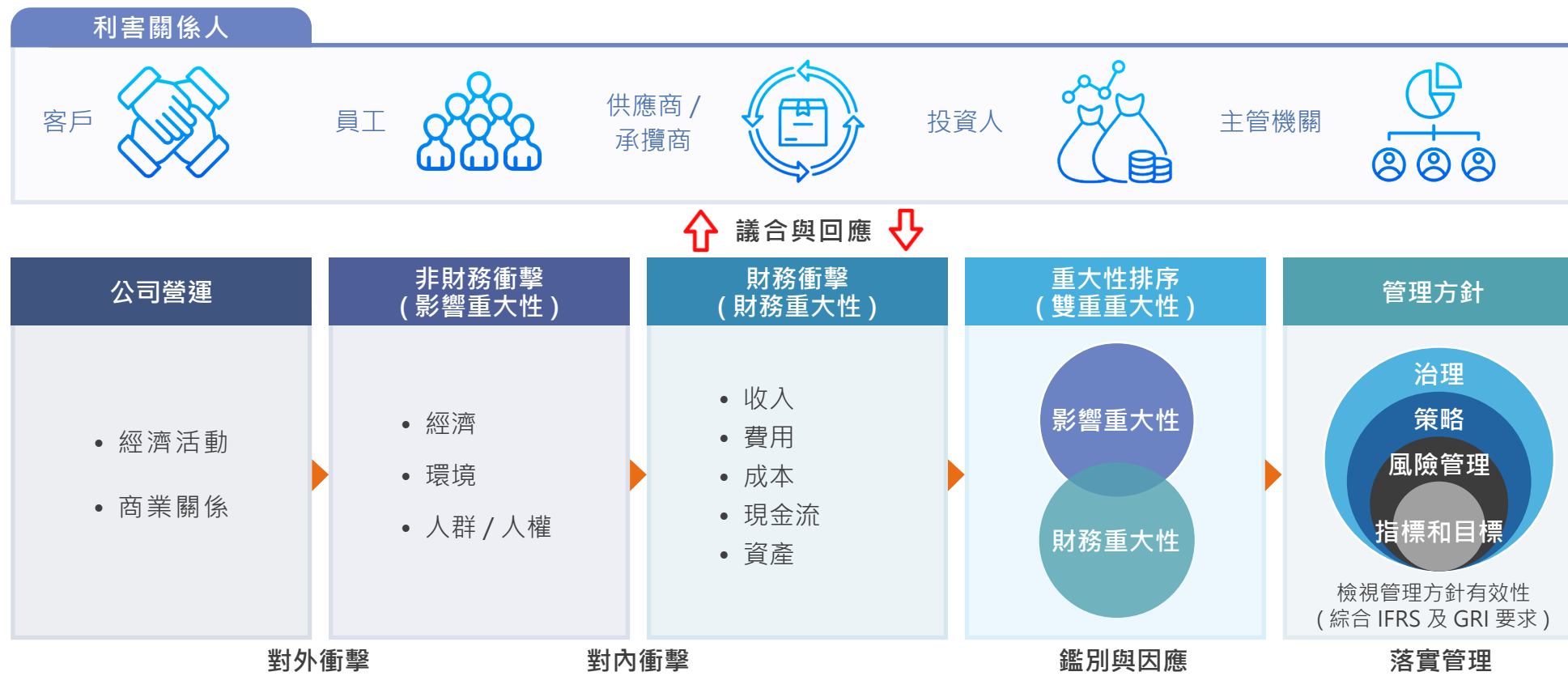


2-2 重要利害關係人議合

利害關係人類型	客戶 	員工 	供應商 / 承攬商 	投資人 	主管機關 
對來頡科技的意義	客戶為影響來頡營收與獲利、產品創新之主要來源，為來頡重要核心商業夥伴。	來頡視員工為最重要夥伴，員工展現的專業能力，成就來頡永續發展的關鍵驅動力。	供應商為提供來頡卓越產品與服務的最佳合作夥伴，為互信的合作關係，一同永續成長。	透過與投資人的溝通，提升市場信任度，進而獲取資金投資，促進公司永續發展。	透過與主管機關維持良好的溝通，了解最新政策規定，確保公司營運符合法規要求，降低潛在風險。
權責部門	業務運營中心 品質保證處	人才數位處	生產管理中心 品質保證處	財會中心 投資人關係暨股務	財會中心 公司治理
議合方式 / 頻率 / 成效	- 客戶拜訪 / 不定期 - 公司網站公布各項業務資訊 / 不定期 - 產品、品質、技術會議 / 不定期 - 客戶滿意度調查 / 每年 (1 次) - 配合客戶稽核 / 不定期 (數次)	- 勞資會議 / 每季 (4 次) - 績效面談 / 每年 (1 次) - 全體員工 Company Meeting 會議 / 每季 (4 次) - 員工申訴信箱 / 即時 - 員工性騷擾申訴信箱 / 即時 - 員工意見調查 / 不定期 (4 次)	供應商評比、稽核 / 每年 (1 次)	- 法人說明會 / 每年 (1 次) - 股東會 / 每年 (1 次) - 公開資訊觀測站 / 即時 - 公司官網 / 即時	- 公開資訊觀測站 / 即時 - 公文往來 / 不定期

2-3 重大性鑑別與分析

來頡科技每年定期進行永續議題衝擊評估，檢視評估結果之高衝擊議題，擬定永續推動策略及行動方案，且針對關鍵項目設定短、中、長期目標。2023 年 IFRS 永續揭露準則、歐洲永續發展報告準則 (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) 相繼正式發布，因此來頡科技以「GRI 3: 重大主題 2021」為基礎，同時亦參酌 IFRS 及 ESRS 針對永續衝擊之指引，以「雙重重大性 (Double Materiality)」原則，將永續衝擊納入影響重大性 (Impact Materiality) 及財務重大性 (Financial Materiality)，進行 5 階段鑑別流程，評估來頡科技營運活動在各項永續層面對社會、環境、人群 (含人權) 之影響性衝擊 (外部衝擊)，以及外部衝擊造成來頡科技須因應該衝擊而投入資源進行管理之財務性衝擊 (內部衝擊)，權衡內外部衝擊產出永續衝擊分析結果，且依此決定優先報導之重大永續議題。同時來頡科技權責部門依據衝擊評估結果，制訂各項議題之政策、推動方案、目標設定。



永續衝擊評估說明

1. 了解組織脈絡

- 鑑別 5 類重要利害關係人之關注議題與可能影響。
- 分析營運活動中的經濟活動與供應鏈上下游商業關係可能形成之衝擊。
- 將可能之衝擊對應至 20 項永續議題。

2. 鑑別對外衝擊（影響重大性）

- 考量持續與利害關係人議合的綜合資訊，由各議題權責部門評估衝擊在實際或潛在、正面或負面等不同面向之影響，從現行管理強度下鑑別對上下游供應鏈、環境及社面面向（組織對外）對 20 項永續議題之影響重大性。
- 鑑別指標：
 - ◆ 負面衝擊之影響重大性：嚴重程度（規模、範疇、可補救性）x 可能性
 - ◆ 正面衝擊之影響重大性：效益程度（規模、範疇）x 可能性

3. 鑑別對內衝擊（財務重大性）

- 財務重大性：依據對 20 項永續議題之影響重大性，由各議題權責部門進一步評估其對營運活動（外部對內）造成短、中、長期造成之財務影響，影響程度係參酌衡量財務報表重大性標準之方式，經分析各項財務指標對來頡科技價值之相關性，以稅前淨利為財務重大性衡量衝擊程度之基準。
- 在評估財務影響時，已充分考慮 IFRS 永續揭露指標、SASB 永續準則之半導體產業所列示之議題及其他財務影響程度相當或更高之議題，確保永續相關風險與機會資訊之完整性。
- 鑑別指標：
 - ◆ 財務重大性：營運衝擊程度 x 可能性

註：所謂之財務影響包含營收、成本、費用、現金流量、籌資 / 融資等相關涉及財務報表之相關資訊。

4. 排序議題衝擊的顯著程度

- 彙總各項議題之影響重大性與財務重大性鑑別結果，依正面 / 負面衝擊分別排序影響重大性與財務重大性外，再與各部門依據來頡科技未來營運規劃確認最終重大性之評估結果。
- 評估 SASB 產業別揭露指標中之關注議題，部分議題在現有管理水準下無顯著衝擊，但仍納入次要議題，以持續關注與揭露必要資訊。

5. 決定重大性永續議題

- 充分考量各項議題之雙重重大性，經由各權責單位討論後，決定優先揭露之重大議題（確認 7 個重大議題）。
- 對應 GRI 主題 / 揭露指標（對應 GRI 4 項主題準則與 2 項自訂主題）。
- 對應 SASB 產業指標：科技與通訊產業（Technology and Communications）之半導體（Semiconductors）產業。

鑑別優先揭露之重大議題

來頡科技本次為首年進行永續議題評估，且採雙重重大性分析，其衝擊分析結果共有 7 項負面重大、6 項正面重大議題，另有 3 項負面次要議題、5 項正面次要議題，列為持續關注之議題，經各權責單位綜合性討論與評估後，針對具有顯著負面衝擊之議題為「創新管理、品質管理、資訊安全、氣候策略、人才吸引與留才、人力資本發展、永續供應鏈」，7 項議題之管理方針及推動成果，列為本報告書優先報導之內容。



排序	影響重大性		財務重大性		雙重重大	
	負面	正面	負面	正面	負面	正面
1	創新管理	創新管理	品質管理	創新管理	創新管理	創新管理
2	氣候策略	品質管理	創新管理	品質管理	品質管理	品質管理
3	資訊安全	氣候策略	人才吸引與留才	人才吸引與留才	資訊安全	永續供應鏈
4	永續供應鏈	永續供應鏈	人力資本發展	人力資本發展	氣候策略	氣候策略
5	品質管理	資訊安全	資訊安全	永續供應鏈	人才吸引與留才	人才吸引與留才
6	廢棄物管理	人才吸引與留才	多元與包容	多元與包容	人力資本發展	人力資本發展
7	產品責任	多元與包容	隱私權保護	稅務管理	永續供應鏈	資訊安全
8	人才吸引與留才	人力資本發展	產品責任	資訊安全	多元與包容	多元與包容
9	多元與包容	稅務管理	永續供應鏈	氣候策略	產品責任	稅務管理
10	人力資本發展	誠信經營	氣候策略	誠信經營	廢棄物管理	誠信經營
11	誠信經營	社會影響力	能源管理	社會影響力	能源管理	社會影響力
12	稅務管理		水資源管理		誠信經營	
13	能源管理		誠信經營		稅務管理	
14	水資源管理		稅務管理		隱私權保護	
15	生物多樣性		廢棄物管理		水資源管理	
16	空污管理		生物多樣性		生物多樣性	
17	職業安全衛生		空污管理		空污管理	
18	隱私權保護		職業安全衛生		職業安全衛生	
19	產品安全與行銷		產品安全與行銷		產品安全與行銷	

註：社會影響力無負面衝擊。

◆ 重大永續議題與標準對應

檢視 GRI 永續報告準則 31 項主題準則，將其與重大議題作對應，選出具有關連性的 4 項 GRI 主題準則及 3 項自訂主題，以及依據 SASB 半導體產業指標進行對應，啟動本報告書之編製程序。

重大議題	正面 衝擊	負面 衝擊	衝擊面向			價值鏈衝擊範疇					GRI 主題準則或 SASB 指標對應
			經濟	環境	人群 (含人權)	更上游 供應商	第一階 供應商	來頡科技	客戶	終端客戶	
創新管理	●	●	●	●					●	●	自訂主題：能耗、效率
品質管理	●	●	●						●		自訂主題：客戶滿意度 TC-SC-410a.1 產品生命週期管理
資訊安全	●	●	●					●	●		自訂主題：資安事件
氣候策略	●	●	●	●			●	●	●		GRI 305 排放 2016 TC-SC-110a.1、TC-SC-110a.2 溫室氣體排放
人才吸引與 留才	●	●	●		●			●			GRI 401 勞僱關係 2016 TC-SC-330a.1 招募及管理全球專業人才
人力資本發展	●	●			●			●			GRI 404 訓練與教育 2016
永續供應鏈	●	●	●	●			●	●	●		GRI 204 採購實務 2016 TC-SC-440a.1 原物料採購

◆ 重大永續主題之衝擊時間範圍

重要揭露議題	情境	對外永續衝擊說明	對內財物衝擊說明	衝擊時間範圍			
				已發生	未來造成衝擊		
					1-2年內	3-5年內	5年以上
創新管理	市場技術人才短缺	負面 - 客戶新的技術需求提高，若未能滿足產品規格或技術研發能力等，可能衝擊客戶產品時程。 - 競爭對手重大創新導致可能技術落後風險。 - 若未能即時因應市場趨勢變化，導致技術創新速度緩慢，錯失市場機會之風險。 - 關鍵半導體技術人才不足影響研發創新，衝擊客戶產品時程。	- 技術創新速度緩慢，衝擊年度營收，連帶研發費用無法提升，新產品數量變少，且舊產品跌價，使毛利下降。 - 關鍵半導體技術人才短缺將限制研發進度，延遲新產品上市時程，影響市場競爭力與營收成長。				
	氣候變遷技術	正面 - 近年創新研發方向著重於綠能環保，如目前的「超級電容」可替代鹼性電池、鋰電池，以及開發低功耗產品等，其環境友善可降低環境衝擊。 - 來頡目前創新研發之電源管理晶片，如電壓穩定、動態響應迅速等，技術領先同業，有助於提升客戶產品性能與市場競爭力。	超級電容管理產品與超低靜態功耗產品預計營收增加。				
品質管理	市場	負面 若發生內部或供應鏈之異常，導致產生不良的產品品質，恐將損害來頡於客戶的企業價值與客戶產品時程。	- 將衝擊後續訂單數量或失去與客戶合作之商業機會。 - 若品質異常之調查結果顯示需大幅改進產品，可能導致額外研發與品質提升成本，短期內影響利潤表現。				
	市場	正面 - 來頡透過「客戶滿意度調查表」，了解客戶之滿意度，作為內部思考產品開發與產品責任之計畫推動外，有助於讓客戶獲得更即時且有效的協助。 - 良好產品品質，會提升來頡於客戶的企業價值，進而取得客戶信任與增加訂單，有助於業績持續成長，此外益於後續客戶端之新產品開發導入。	- 透過客戶滿意度調查，可提升產品競爭力與市場接受度，進而增加銷售與營收。同時，針對產品責任的改進可降低品質缺陷與潛在索賠風險，減少相關財務損失。 - 穩定的產品品質，有助於增長業績並減少潛在財務風險。				

重要揭露議題	情境	對外永續衝擊說明		對內財物衝擊說明	衝擊時間範圍			
					已發生	未來造成衝擊		
						1-2年內	3-5年內	5年以上
資訊安全	網路犯罪	負面	近期國內外企業遭受資安攻擊事件頻繁，若發生重大資安事件，如受外部勒索病毒攻擊，可能造成公司營運中斷風險，影響出貨排程，且造成客戶商業機密與公司員工個人資料洩漏之可能性。	為降低資安風險，導入 MDR 端點防護偵測系統、弱點掃描、社交工程演練，管理成本增加。	●			
	技術法規	正面	透過提升資安意識、技術創新（如人工智慧和機器學習來偵測和防禦攻擊）、強化合規性與風險管理，透過前述方式，有效保護客戶與來頡商業機密與數據資產，以及減少員工個資外洩與保障商業機密。	現行資訊安全措施有助於防止內部或外部的安全事件，從而減少數據丟失、業務中斷或詐騙事件所帶來的損失。	●			
氣候策略	市場法規	負面	極端氣候事件發生機率逐年提升，降低碳排放量成為國內外上市櫃公司（國際品牌大廠）選商的主要原則，若未能及早將氣候變遷之影響整合至營運策略，除增加環境衝擊外，可能影響來頡實體營運或供應鏈韌性。	受氣候變遷影響，因應客戶或供應商對減碳與永續發展的要求日益提升，需投入更多資源以符合相關標準與規範，可能導致企業營運成本的增加。	●			
	技術	正面	來頡產品之低功耗與高效能的設計，透過技術創新，不僅持續優化功耗，亦在產品體積上精進設計，進一步提升能源效率，有助於降低終端使用者的能耗與溫室氣體排放，也協助客戶成為降低氣候變遷助力。	隨著客戶對於節能產品的需求日益增加，將帶動訂單成長，進而有助於提升公司財務收入與市場競爭力。	●			

重要揭露議題	情境	對外永續衝擊說明	對內財物衝擊說明	衝擊時間範圍			
				已發生	未來造成衝擊		
					1-2年內	3-5年內	5年以上
人才吸引與留才	聲譽市場	負面 來頡目前公司知名度、技術領先地位與產品市占率，影響到人才招聘時面試率、報到率；且若離職率高可能產生人才流動推力，進而提升招募成本及培訓成本，連帶使企業形象及雇主品牌受影響。	- 招募人力及時間成本提升。 - 新人晉用培訓成本提升。 - 維護企業形象及雇主品牌成本提升。				
	聲譽市場	正面 若未來提高留任率，可使優秀人才於組織內逐漸發揮正向影響力，帶動績效成長並吸引外部優秀人才加入。	優秀人才有效使研發創新能力與競爭力提升，市場機會增加。				
人力資本發展	聲譽市場	負面 - 目前公司知名度、技術領先地位與產品市占率，影響到人才招聘時面試率、報到率。 - 若缺乏員工專業培訓計畫，使員工無法學習業界新知，將不利於產業創新及生產動能。	- 若人才未具備專業能力無法洞察商機，使收入減少。 - 未拓展產品藍圖使收入減少。				
	聲譽市場	正面 來頡未來將強化員工專業培訓計畫，使員工具備適應半導體業快速變化之能力，從而創造更多價值，包含提升員工競爭力、促進職涯成長、推動創新能力與提高設計IC效率等益處。	人才具備專業能力與洞察商機能力，可拓展產品藍圖使收入增加。				
永續供應鏈	地緣政治國際衝突市場	負面 因全球經濟貿易情勢，客戶要求來頡或來頡合作對象，需非屬美國制裁名單（SDN List）。半導體業產品與原物料涉及上下游供應鏈需審慎進出口管理，避免觸及SDN List 中對象（如中國大陸部分貨品 ex12 類半導體晶圓製造設備），以致客戶受到國際組織制裁，影響進出口。	未避免觸及 SDN List，生產地需要轉移、更換供應商，其庫存與成本提高。				
	市場流程	正面 - 現行客戶關注減碳、環保與節能等議題，生產供應鏈管理要求符合相關法規方能得到客戶認證，以此目標要求供應商共同改善且制定相關規範提升生產競爭力降低環境影響。 - 內部透過增加生產效率，讓單位時間產出增加或單位產出減少生產工時、減少人力物力，同時亦達節能減碳的效能。	效率增加相對生產成本減少，惟耗材費用會增加。				

2-4 永續議題管理方針

重大主題名稱	永續供應鏈	
政策 / 承諾	依據「供應商管理辦法」，確保選擇提供穩定品質與技術、合理價格、良好服務態度且可滿足交期的合格供應商。	
管理責任	- 生產管理中心 / 資深協理 (中心級) - 品質保證處 / 協理 (處級)	
目標	2024 年	落實年度供應商管理，請供應商簽署社會責任宣導函。
	短期 (1~2 年)	- 深化區域性策略合作，持續提升各區域在地採購，以分散風險。 - 因應 OOC 要求及政策，積極推動供應鏈多元化，擴展至中國大陸以外地區，以降低地緣政治風險。
行動方案	每年進行供應商稽核與評比。	
年度成果	- 稽核與評比完成率 100%。 - 供應商社會責任宣導函簽署率 100%	
追蹤檢討機制	每年召開內部會議討論供應商各項管理指標達成情形。	
利害關係人議合	供應商：透過年度供應商管理評鑑、稽核，不定期拜訪或會議方式討論產品交期及供貨品質等資訊回饋。	

重大主題名稱	創新管理	
政策 / 承諾	- 持續投入研發資源，挑戰及研究新技術，開發更高規格的产品，提供客戶創新、可靠、高效率及高 CP 值的產品，讓 M3TEK 成為客戶首選電源管理方案供應商。 - 協助客戶達體積縮小、節省能源、降低碳排放量及更高效能的電源管理之效果。	
管理責任	新技術發展處 / 協理 (處級)	
目標	2024 年	以嚴謹產品開發流程評估新產品、新技術可行性，開發符合市場需求的優異產品。 - 定義開發 LIC 超級電容管理產品 - 定義開發大電流超級電容充電產品 - 第一款超低靜態功耗 BUCK 推出 - 定義開發超低靜態功耗升壓電路 (BOOST)、升降壓電路 (BUCK-BOOST)
	短期 (1~2 年)	- 成功推出超級電容相關產品。 - 完善超低靜態功耗產品線。 - 市場研究以及定義開發電能收集產品。
行動方案	- 展開全系列的超低靜態功耗產品計畫。 - 展開多種超級電容技術的全系列超級電容產品計畫。	
年度成果	相繼推出 MT2601 及 MT2603LIC 超級電容管理晶片，解決鋰電池所造成的環境汙染和需要專業回收的需求，以及防止電池爆裂的可能性。	
追蹤檢討機制	- 不定期召開產品研發測試會議。 - 客戶拜訪，需求蒐集整理以及客戶問題分析。	
利害關係人議合	客戶：透過客戶溝通與服務機制，提供客戶在針對產品或服務有相關問題或建議時，可及時溝通與回應。	

重大主題名稱	資訊安全	
政策 / 承諾	- 依據「電腦系統安全管理辦法」保護公司業務服務安全，避免未經授權修改，確保其正確性與完整性。 - 依據「緊急應變暨系統復原計劃作業程序」確保公司業務服務之持續運作。 - 強化人員資安意識，企業同仁應參與資通安全相關教育訓練，以提高全公司資通安全意識。	
管理責任	人才數位處 - 資訊數位部 / 資深經理	
目標	2024 年	- 確保全體人員了解其資訊安全責任，保護資訊資產。 - 評估 / 導入 ZTNA 系統，保護企業的資訊資產。 - 執行資訊資產風險評估。 - 資安檢測通過率 95% 以上。 - 每年至少一次實際演練系統異地還原演練。 - 規劃端點偵測與回應系統布建。
	短期 (1~2 年)	- 完成資訊資產風險管理作業，確保企業能夠應對各種潛在威脅。 - 遵守相關法律法規和行業標準，確保資訊安全管理體系符合要求。 - 不定期進行資訊安全培訓，提高員工的安全意識和技能。 - 資安檢測通過率 95% 以上。
行動方案	- 進行員工資訊安全意識培訓。 - 導入先進的資訊安全技術 (如：ZTNA) 。 - 進行使用者自評資訊資產風險評估。 - 實施資安檢測。 - 進行資料備份與災難還原演練。 - 導入端點防護與回應系統 (MDR) 。	
年度成果	- 發布資安宣導 18 次。 - 完成資訊資產風險評估。 - 資安檢測通過率 80% (約 20% 同仁觸發測試郵件) 。 - 完成主要災難還原演練。 - 全面完成端點偵測與回應系統布建。	
追蹤檢討機制	執行項目列入年度 KPI，透過每年管理審查會議檢討進度。	
利害關係人議合	員工：透過內部網站進行資安宣導，建立同仁資安意識。	

重大主題名稱	客戶關係 (含品質管理)	
政策 / 承諾	提供並推廣客戶節能產品，達到客戶產品能耗降低目標。	
管理責任	業務運營中心 / 資深協理 (中心級)	
目標	2024 年	致力研發低功耗產品，達成客戶終端產品能耗降低目標，提升產品的環保效益。
	短期 (1~2 年)	- 提升客戶滿意度，增強品牌忠誠度。 - 增加節能產品的市占率。
行動方案	- 針對節能產品市場進行推廣調查與執行客戶滿意度調查。 - 依循品質管理系統落實執行，確保產品和服務的品質。	
年度成果	客戶滿意度調查問卷共計回收 20 份，其中 85% 的客戶對來頡的整體表現評級為滿意 (含) 以上。	
追蹤檢討機制	透過客戶滿意調查成果檢討年度客戶滿意度。	
利害關係人議合	客戶：不定期參加客戶會議、培訓以及建立與客戶的良好溝通管道，確保客戶需求被充分考量。	

重大主題名稱	氣候策略	
政策 / 承諾	- 持續專注於研發低碳排放、高效能的產品，藉此提升能源使用效率，實現綠色產品之發展方向。 - 依據客戶降低耗能的需求，導入設計開發概念。	
公司治理主管	- 新技術發展處 / 協理（處級） - 公司治理主管	
目標	2024 年	- 開發低功耗、高效能的產品 MT8351，並積極進行節能設計，以降低整體能耗。 - 推出 MT2601 超級電容管理晶片。
	短期 (1~2 年)	- 推出 MT2603LIC 超級電容管理晶片。 - 發展綠色產品，以滿足市場需求，提升競爭力。 - 提供符合所有市場產品效率法規與標準之解決方案。 - 加強辦公室用電宣導，以達到低碳營運的目標。
行動方案	持續積極將節能減碳技術應用於產品設計，並在生產過程中導入高效能技術，從而達成減少能源消耗和碳排放為目標。	
年度成果	透過不斷的技術創新，我們除優化產品的功耗外，更在設計上提升了產品的體積效率，進一步提高了能源使用效率。與客戶傳統解決方案比較，MT2601/2603 透過高度集成和高效能電能管理，減少了外部元件數量和所需的超級電容容量，整體方案可以實現 60% 的體積減小和 40% 的能耗降低，有助於減少終端用戶的能耗與溫室氣體排放，也為客戶提供更永續的解決方案。	
追蹤檢討機制	每季董事會追蹤檢討溫室氣體管理情形。	
利害關係人議合	透過不定期 ESG 教育訓練，讓全體同仁了解目前世界所面臨的氣候變遷狀況，增加同仁對於此議題的關注及認知。	

重大主題名稱	人力資本發展 (含吸引與留才、教育訓練)	
政策 / 承諾	我們遵守勞動相關法規，建立多元、平等、包容不歧視不強迫勞動之友善工作環境，致力於福利與薪資的提升。	
管理責任	人才數位處 / 資深協理 (處級)	
目標	2024 年	- 聘任公司治理主管 1 名。 - 安排外部顧問進行 ESG 認知教育訓練。
	短期 (1~2 年)	- 訓練技能發展：培育員工 ESG 發展認知、強化各職級專業技能。 - 文化倡導：推動企業 ESG 組織文化，並使員工參與度提高。
行動方案	2024 年啟動 ESG 專案。	
年度成果	- 完成聘任公司治理主管 1 名。 - 完成 ESG 認知教育訓練，各單位主管參與率 100%。	
追蹤檢討機制	每季定期追蹤 ESG 進度，並在內部會議討論。	
利害關係人議合	員工可透過主管溝通會議、績效面談會議、勞資會議，或可於官網「利害關係人專區」頁面進行意見回饋與檢舉或申訴。	

3-1

溫室氣體排放

來頡科技依循溫室氣體盤查議定書 (GHG Protocol) 每年進行溫室氣體盤查並編製盤查報告書，持續掌握溫室氣體排放現況與管理工作。來頡為無廠半導體的設計公司，組織內營運活動皆於辦公大樓，所使用能資源之產生的溫室氣體排放源為辦公室日常所需冷氣、冰箱、冰水主機，實驗室設備與外購電力等，來頡自 2025 年起展開 2024 年溫室氣體盤查，範疇一與範疇二總排放量為 91.2767 公噸 CO₂e，主要以範疇二外購電力為大宗占總排放量 91.47%，範疇一則占 8.53%。

有鑑於氣候變遷對環境、社會的威脅，與呼應台灣 2050 淨零排放目標，來頡科技將持續進行溫室氣體管理，除規劃可行之減量策略外，未來亦將盤查範疇擴大至範疇三，瞭解價值鏈排放情形掌握上下游非自有或可支配的排放源，以利更確實擬定溫室氣體管理策略，共同為提升價值鏈碳數據透明度貢獻。

揭露主題：溫室氣體排放

指標編號	指標項目	2024 年
TC-SC-110a.1	全球溫室氣體總排放量 (範疇一) (單位：公噸 CO ₂ e)	來頡科技範疇一為 7.7898 公噸。
	來自全氟化合物 (PFCs) 的總排放量 (單位：公噸 CO ₂ e)	來頡科技屬於無廠半導體設計公司無半導體製程，因此無任何 PFCs 之排放。
TC-SC-110a.2	論述管理範疇一排放量的短中長期策略或計畫、減量目標及其績效分析。	來頡科技範疇一主要排放源來自於冰箱、實驗室設備、冷氣等冷媒設備之逸散排放，因減量空間有限，評估未來設備汰換時選用 GWP 值較低之冷媒。

溫室氣體排放量 (單位：公噸 CO₂e)

年份	範疇 1		範疇 2	溫室氣體 總排放量	溫室氣體排放密集度 (公噸 CO ₂ e / m ²)	溫室氣體排放密集度 (公噸 CO ₂ e / 營業額百萬元)	範疇 3 與燃料及能源相關活動 (未納入範疇一或範疇二)
2024 年	HFCs	PFCs	83.4869	91.2767	0.1836	0.1006	17.1377
	7.0518	0.738					
	7.7898						

註 1：盤查之溫室氣體包含 CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃，因來頡科技無製程，故無產生 SF₆、NF₃。

註 2：盤查範疇為來頡科技台北與新竹辦公室，彙編溫室氣體排放量的方法採用營運控制法。

註 3：各項溫室氣體之全球暖化潛勢值 (GWP) 係依據 IPCC 於 2021 年發布之第六次評估報告 (AR6)。

註 4：範疇一排放係數來源係參考環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4。

註 5：2024 年為來頡科技首年台北與新竹據點完整盤查之數據，故選用該年度為基準年。

註 6：範疇二為能源署 2025 年公告 2024 年電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/ 度。

範疇三之電力間接碳足跡 (2021) 排放係數為 0.0973 kgCO₂e。

註 7：依「公開發行公司年報應行記載事項準則」附表二之二之三「上市上櫃公司氣候相關資訊」之規定，溫室氣體排放量密集度至少應揭露以營業額 (新臺幣百萬元) 計算。

3-2 能源管理

來頡科技營運空間以辦公室為主體，整體的能源使用以空調、照明、電腦資訊設備、實驗設備等，然而辦公大樓為租賃，部分設備如冰水主機屬於辦公大樓無管理權限。來頡科技使用之能源 100% 為外購自台電公司之非可再生電力，電力耗用量來自於辦公室用電、辦公大樓公共用電以及資訊設備於第三方機房用電，其電力耗用量占總能源耗用量 100%。

2024 年能源總耗用量為 634.079 GJ (總用電量為 176,133 度)。能源種類依其性質以營運活動密切相關，亦以營收作為密集度之計算基礎，2024 年單位能源密集度為 0.699 GJ / 百萬營收。

來頡科技持續推動辦公室節約用電外，針對產品與技術方面，來頡將提升製程技術，減少產品改版時光罩的使用，並開發小體積、高效率、低待機功耗及高整合度的節能電源管理 IC，以助客戶與消費者實現減碳目標，同時達成企業永續發展願景。

揭露主題：製程能源管理

年份	指標項目	2024 年
TC-SC-130a.1	(1) 能源總耗用量 (含燃料、電力) (GJ)	634.079 GJ
	(2) 使用電網占總能源耗用之百分比	100 %
	(3) 使用再生能源占總能源耗用之百分比	0 %

註：單位換算：1 kWh (度) = 860 Kcal、1 Kcal = 4.186798 J，因此 1 kWh (度) = 3.6×10^{-3} GJ。



3-3

水資源管理

來頡科技無自有製造工廠，所有產品 100% 委外生產，取水用途僅為辦公室員工一般生活用水使用，取水來源來自台灣自來水公司（第三方的水）。2024 年總取水量為 0.42 百萬公升（ML）。

因來頡營運屬性，排水量則皆為生活汙水，由辦公室大樓直接排出至生活下水道，無流量計可統計實際排水量，故以取水量 100% 概估為排水量之方式進行揭露。耗水原因包含空調用水逸散於空氣中，以及員工之飲水需求，由於其數量相較未具顯著性且缺乏合理之統計方法，此揭露忽略相關耗水量。此外，來頡科技台北與新竹辦公室已採用感應式水龍頭，並持續推動節水宣導，以提升用水效率。

揭露主題：水資源管理

指標編號	指標項目	2024 年
TC-SC-140a.1	(1) 取水量(千立方公尺)，自水資源壓力區(高度與極高)取水量占總取水量的百分比。	0.42 千立方公尺
	(2) 耗水量(千立方公尺)，自水資源壓力區(高度與極高)耗水量占總耗水量的百分比。	來頡科技營運據點所在之新竹縣與台北市，根據 WRI 水壓力評估地圖之資訊，非屬高或極高之風險區域，因此取自水資源壓力區之百分比為 0%。
註：千立方公尺 (1,000 m³) = 百萬公升 (megaliters, ML)。		

水資源概況	
年度	2024 年
取水量 (百萬公升)	0.42
排水量 (百萬公升)	0.42
取水密集度 (百萬公升 / 樓地板面積 m²)	0.0008

3-4 廢棄物管理

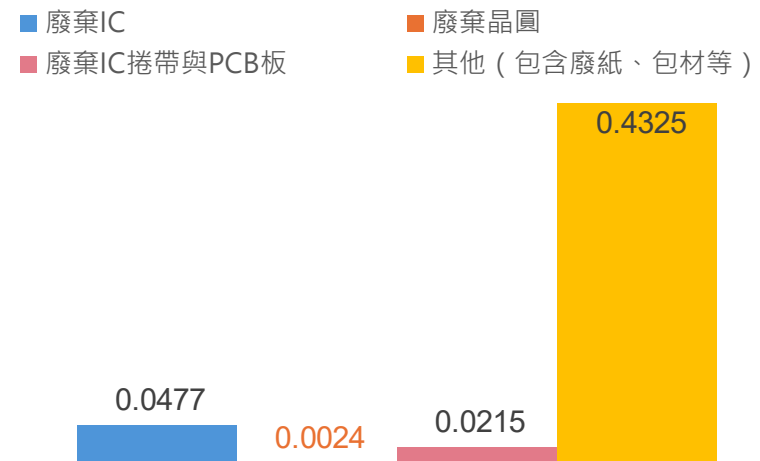
來頡科技營運過程產生之廢棄物主要為員工在辦公室工作時產生之事務類與生活廢棄物，以及實驗室或工程單位的事業廢棄物。其中事業廢棄物主要來源有三：實驗室或工程單位所廢棄的 IC、PCB 板及儀器設備；因產品改版或驗證不通過的廢棄 IC 及晶圓；廢棄 IC 或晶圓所產生的廢棄紙箱及相關包材。來頡科技為無晶圓廠 IC 設計公司，因此未有製程產生的有害廢棄物。

主要事業廢棄物包含廢棄 IC、廢棄晶圓、廢棄 IC 捲帶與 PCB 板、其他（廢紙與包材等），可區分為 E 類混合五金廢料與 R 類公告應回收或再利用廢棄物，均屬於離場處理（無現場處理）。2024 年廢棄物合計 0.5041 公噸，有害廢棄物與非有害廢棄物比例分別為 14%、86%。

指標編號	指標項目	2024 年
TC-SC-150a.1	製造過程中所產生的有害廢棄物的製造總量（公噸）	0.0716 公噸
	有害廢棄物的回收比例 ^註 （%）	100%

註：回收比例 = 回收有害廢棄物重量 / 產生的有害廢棄物總重量

2024 年廢棄物產生量（單位：公噸）



單位：公噸	回收再利用			直接處置		
	有害	非有害	總重量	有害	非有害	總重量
2024 年	0.0716	0.4325	0.5041	-	-	-
比例	14%	86%	-	-	-	-

註：有害廢棄物皆屬於回收再利用中之其他回收作業類型，均定期委託合格廢棄物處理公司處置。

3-5

員工健康與安全

來頡科技依據「安全衛生工作規則」定期召開訓練課程以落實安全衛生防護。來頡新人訓練涵蓋職業安全衛生訓練課程，規定新人入職二週內完訓，2024 年新人完訓率 100%。

公司作業環境主要皆為透過電腦執行相關作業，日常作業不涉及任何危害健康之物質及化學物質，僅於實驗室研發測試的焊接作業環節會接觸到化學物品鉛，然而來頡針對實驗室場域加裝排風設備，避免同仁過度接觸化學物質，且不定期請專業機構檢驗來頡實驗室場域，並未檢出化學物質超過容許限值，以確保員工工作環境安全無虞。



指標編號	指標項目	說明
TC-SC-320a.1	論述如何評估、監控與減少員工暴露於有害環境的方法及成果	來頡科技為 IC 設計業，晶圓製造委外供應商加工製造，於供應商篩選我們選擇符合相關 ESG 標準之企業，確保我們的員工於外部工作場域之健康與安全。
TC-SC-320a.2	因違反員工健康與安全法規相關之事件所造成的損失總金額（單位：新台幣）	近三年無違反員工健康與安全法規相關之事件。

健康促進	內容
健康大步走活動	- 定期舉辦「健康大步走」活動，促進員工健康並鼓勵運動競賽，鼓勵全員參與。比賽選出各公司前三名及最佳團隊，頒發獎金與健康假以茲獎勵。 2024 年「健康大步走」活動邀集台灣與中國大陸同仁共襄盛舉，吸引 57 名員工參加，參與率達 62%。
健康檢查	提供健康檢查：依職務區分為三類健檢方案，依男女生理結構之重點項目進行分類分項之員工健檢；員工健檢後依個人健康檢查狀況自行進行衛教諮詢或門診檢查。

3-6

招募及管理全球專業人才

指標編號	指標項目	2022 年	2023 年	2024 年
TC-SC-330a.1	說明需要工作簽證的員工比例	2.5%	2.3%	0%

「來頡科技視員工為最重要的最佳夥伴，其所展現的專業能力與天賦才能，成就來頡科技永續發展的關鍵驅動力。」來頡秉持此企業核心理念，致力打造多元、平等、包容的工作環境，使員工能積極發揮所長。

確認需求

- 釐清職缺需求，確認職位所需技能與條件。
- 撰寫職務說明。

投放職缺

- 透過多元管道擴大人才搜尋範圍，吸引適合的應徵者。

履歷篩選

- 初步依據用人需求篩選合適履歷。

面試甄選

- 第一輪面試：由 HR 即直接主管進行行為及專業評估。
- 第二輪面試：由間接主管就專業技術及潛在發展評估。
- 第三輪面試 (關鍵職務)：由高階主管進行企業文化、領導決策評估。
背景調查 (特定職務) 與資歷查核。

任用錄取

- 綜合考量應徵者面試表現與適配性，並依據內外部公平性與競爭性提出合理薪酬方案。
- 雙方確認任用條件發出錄取通知。

招募與任用

來頡科技致力於打造多元、平等、包容 (Diversity , Equity and Inclusion , DEI) 的職場環境，我們堅信每位員工無論其性別、年齡、種族、國籍、宗教信仰、性傾向、身心障礙、社會經濟背景，均應享有平等的就業機會與職涯發展資源。因此，我們在人才招聘過程中，嚴格恪遵「就業服務法」，杜絕所有就業歧視，確保應徵人選可以在就業平等的基礎上獲得相同工作機會。

來頡科技透過多元化的招募方式，吸引來自不同背景、專業領域的潛在人才，確保公司持續擁有多元觀點與不斷創新的動能。

公開招募平台

我們透過台灣的 104 人力銀行投放職缺資訊及公司品牌觸及廣大受眾，提升企業雇主品牌曝光度，並針對不同職缺透過 104 人力銀行提供的智能配對機制尋覓合適人才，以及依據平台數據分析，優化招募效率並調整招募策略。

獵才機構

針對關鍵職位、高階主管及特殊技術人才，除於公開平台招募外，更與專業獵才機構 (Headhunter) 合作，協助來頡尋找合適的中、高階職位以及特殊職位的人才，精準有效找到適才適所且符合企業文化組織發展的潛在人才。

內部舉才

我們相信現有員工都是最好的品牌大使，因此我們設立內部舉才獎勵制度 (Internal Talent Referral)，鼓勵員工透過口碑傳播及人脈網絡，推薦符合企業文化與專業需求的優秀人才。

人力概況

來頡科技員工人數逐年穩定成長，截至 2024 年底，來頡科技集團全球員工總數為 94 人分別為：台灣 47 人、中國大陸 45 人、美國 2 人。

2024 年台灣在職員工共 47 人，全數為永久聘僱的全職員工。

女性占比為 40.43%

男性占比為 59.57%

以年齡別區分，

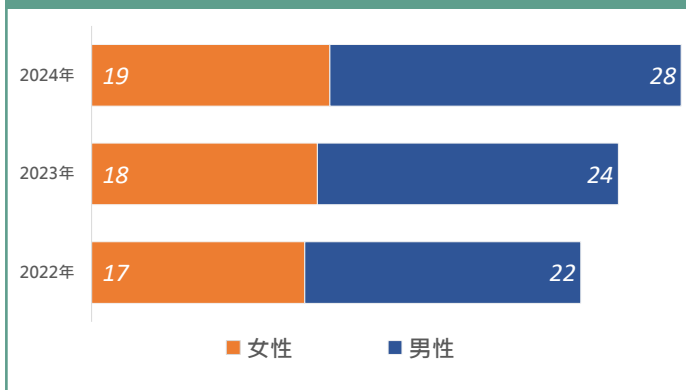
30 歲以下占比為 23.40%

31-50 歲占比為 68.09%

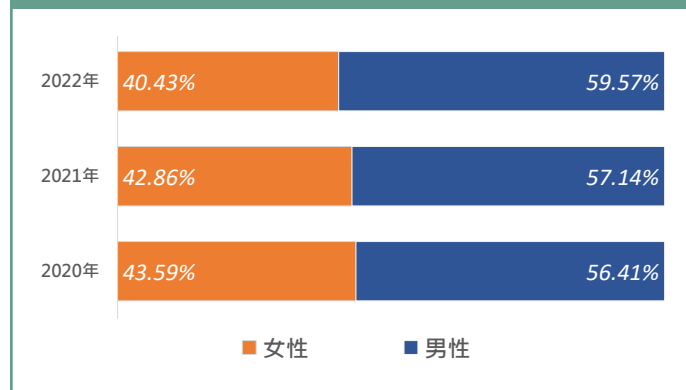
51 歲以上占比為 8.51%

員工結構以壯年世代擔綱主力，具備承先啟後的專業經驗與穩定性，有助於驅動公司穩健成長。

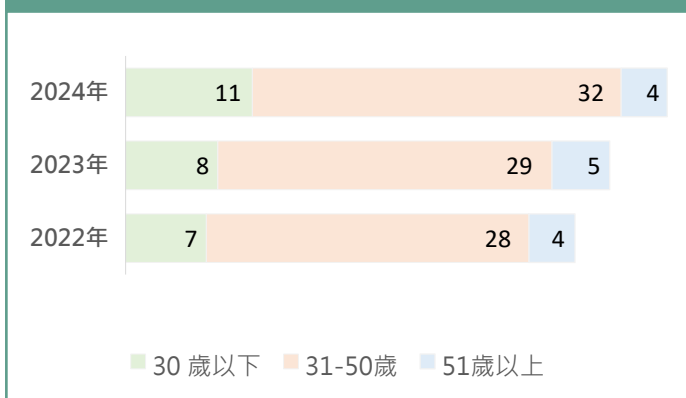
歷年聘用員工總人數 (依性別)



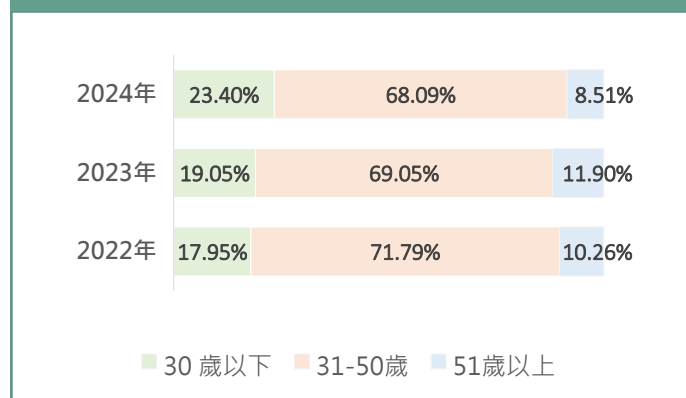
歷年聘用員工性別比例



歷年聘用員工總人數 (年齡別)



歷年聘用員工年齡別比例



註：人力數據分析以來頡科技台灣為主，未來將統計數據擴大至其他子公司。

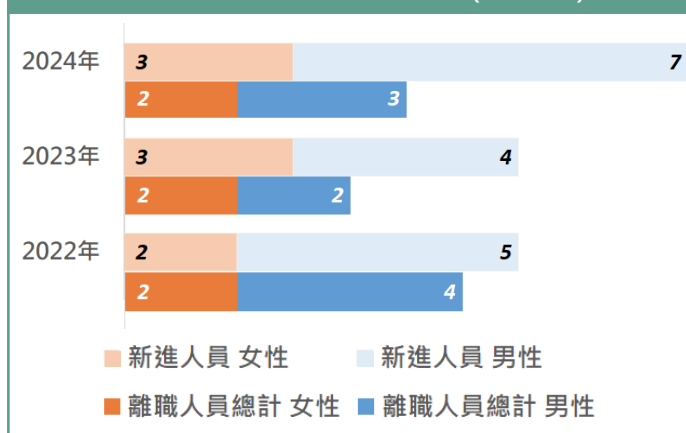
人力流動

2024 年員工新進人數共計 10 人，
員工整體年新進率為 21.28%。
(女男比例為 3 : 7)
女性 3 人 (占比 15.79%)
男性 7 人 (占比 25.00%)
30 歲以下 4 人 (占比 36.36%)
31~50 歲 5 人 (占比 15.63%)
51 歲以上 1 人 (占比 25.00%)

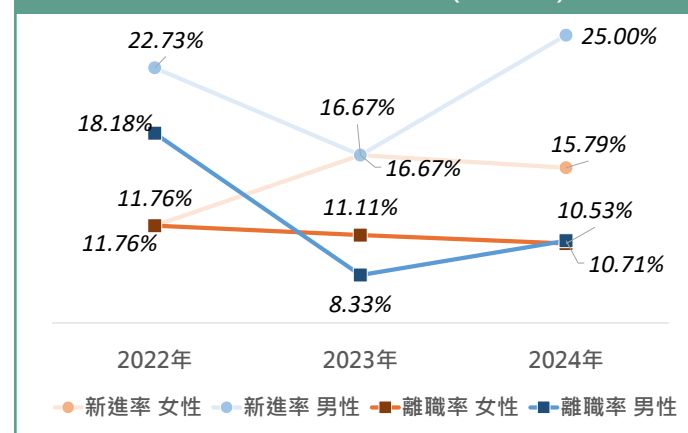
員工離職人數共計 5 人，
員工整體年離職率為 10.64%。
(女男比例為 4 : 6)
女性 2 人 (占比 10.53%)
男性 3 人 (占比 10.71%)
30 歲以下 1 人 (占比 9.09%)
31~50 歲 2 人 (占比 6.25%)
51 歲以上 2 人 (占比 50.00%)

我們持續落實績效考核制度並逐年
檢視員工福利措施，以提升適任員
工留任率，並注入優秀人才新動能。

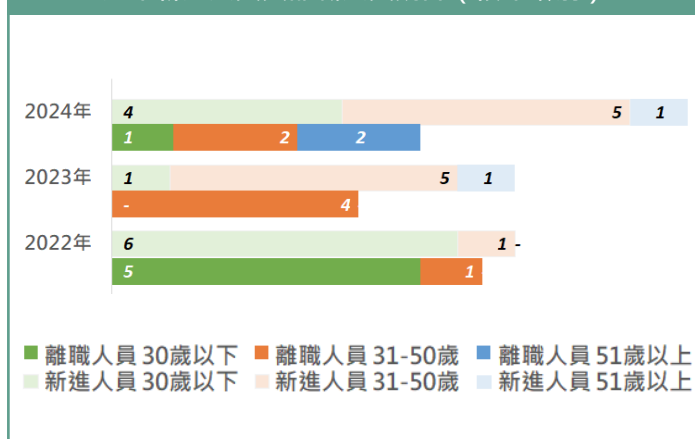
歷年新進人員與離職人員統計 (依性別)



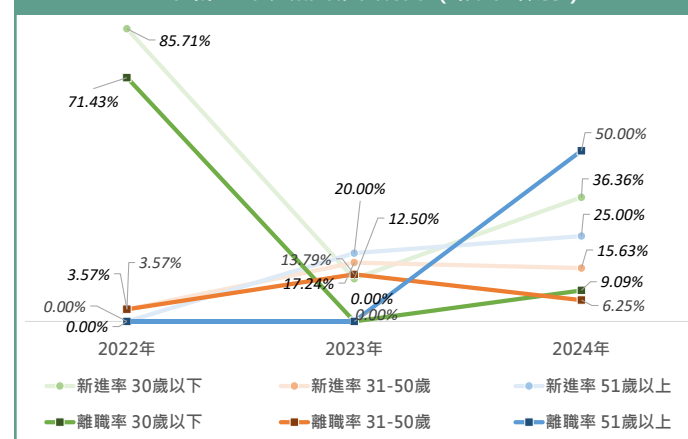
歷年新進率與離職率統計 (依性別)



歷年新進人員與離職人員統計 (依年齡別)



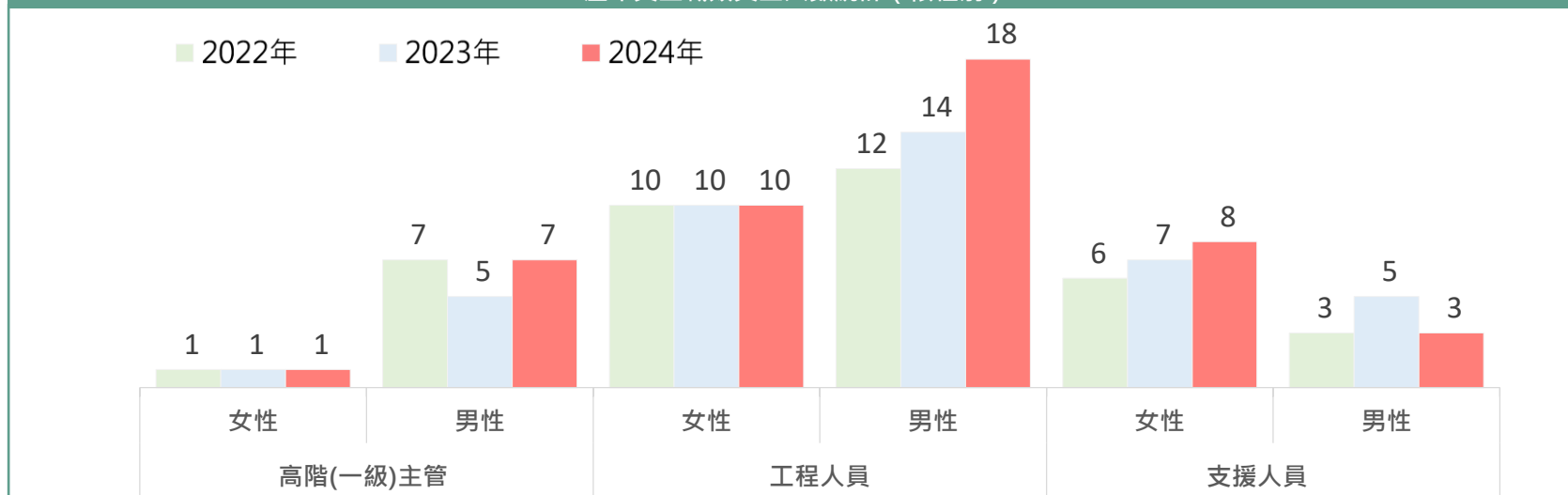
歷年新進率與離職率統計 (依年齡別)



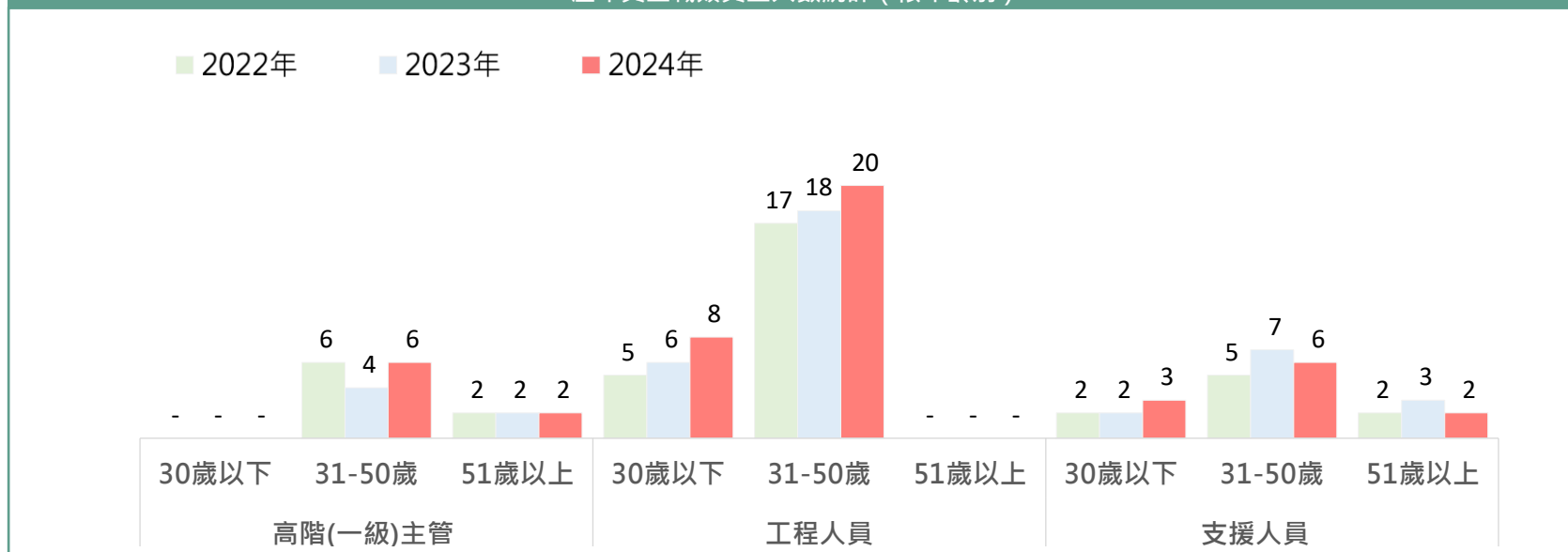
註 1：新進率 = 該類別當年度新進人數 ÷ 該類別當年度年底在職總人數

註 2：離職率 = 該類別當年度離職人數 ÷ 該類別當年度年底在職總人數

歷年員工職類員工人數統計 (依性別)



歷年員工職類員工人數統計 (依年齡別)



註：高階主管為部門主管且具經理人身分者、工程人員為工程 / 品保 / 研發人員、支援人員為財會 / 資訊 / 業務 / 人資 / 公司治理 / 稽核等人員

離職訪談

針對離職員工由直接主管進行離職訪談瞭解離職原因以及對於公司制度面看法，並將結果回饋予權責單位進行改善調整。來頡科技從質化結果進行根因改善，藉此提升員工留任意願。自 2024 年起統計離職率（基準年）且設定 2025 年離職率目標於 10% 以下，展現我們對於員工夥伴的重視程度。

績效考核

來頡科技依據「員工績效管理辦法」，透過目標管理與績效評估進行年度員工績效考核，秉持公平、公正、客觀三大原則進行，激勵員工表現，促進個人與公司共同成長。2024 年員工績效考核執行率 100%。



獎酬與福利

來頡科技秉持公平原則，建立完善的薪酬政策與決策流程，確保薪酬制度具吸引力，能有效留任並激勵優秀人才。

外部公平性

透過不定期薪資調查，確保薪資水準具有市場競爭力，吸引外部優秀人才。

內部公平性

考量部門職責、能力要求及工作複雜度，確保薪資結構合理且一致。

個人公平性

根據個人績效與團隊貢獻，提供差異化的獎勵機制，以實現長期激勵效果。

我們提供員工多元化獎酬，以強化激勵效果，並與公司績效與永續發展目標緊密結合，以形成良性循環。獎酬內容包含端午獎金、中秋獎金、年終獎金等年節獎金等基本保障外，依公司年度獲利盈餘，參考員工績效表現合理分配員工酬勞及績效分紅，共享公司經營成果，另外對於關鍵人才提供員工認股計畫，以提升關鍵人才留任率。

2024 年全體員工男女薪酬比例略有差異，其原因為因半導體產業特性，研發技術、高階主管等相關人力以男性占多數，及員工年資與學經歷不同等因素，因此男性平均薪資高於女性。

薪酬男女比例		2024 年
平均薪資 / 獎金 差異百分比	全職員工平均月薪差異比（女 - 男）	-19.88%
	中位數員工平均月薪差異比（女 - 男）	-8.09%
	全職員工平均獎金差異比（女 - 男）	-23.83%
	中位數員工平均獎金差異比（女 - 男）	-8.16%
平均月薪比率 （依職級別）	一級主管（高階主管）以上平均月薪比（女 / 男）	0.71
	非主管人員平均月薪比（女 / 男）	1.03
平均年薪（含獎金） 差異比率	一級主管（高階主管）以上含獎金之年薪平均金額比率（女 / 男）	0.60
	非主管人員含獎金之年薪平均金額比率（女 / 男）	1.11

註：月薪計算為基本薪資含經常性薪資，全年保障 14 個月以及含伙食津貼；平均月薪為 2024 年全年度全體員工月薪的加總平均。

非擔任主管職務之全時員工薪資 (單位：仟元)	2022 年	2023 年	2024 年
平均薪資	1,704	1,024	1,210
中位數薪資	1,562	956	1,110
同業平均薪資	1,965	1,745	1,998
平均薪資為同業之倍數	0.87	0.59	0.61

註：此資料與公開資訊觀測站揭露一致 (股票代號：6799)

員工認股計畫

被授予員工	依據工作績效、整體貢獻、特殊功績、年資、考核等因素，給予員工認股。
目的	為留任優秀員工，並提高員工對公司之向心力及生產力，以期共同創造公司及股東之利益。
目標	關鍵人才留任： 對公司策略發展、產品創新、經營獲利、生產管理、公司治理及擔負公司經營績效具有貢獻之關鍵性人才。 授予員工認股計畫原則： - 對公司研發新產品或新技術具有貢獻 - 對公司業績貢獻、後端生產維運、新產品定義或專利發明具有貢獻 - 對公司經營管理績效財務分析或市場發展客戶應用服務具有貢獻 - 對公司品質管理產品工程、人力資源管理或非經理人但對公司新產品研發或應用工程等具有貢獻 關鍵人才招募： 公司對外招募對公司未來經營發展或營運具有關鍵性職位之人才。

註：範疇適用於台灣、中國大陸與美國

完整福利

福利類型	項目	優於法規差異說明
獎金類	年節獎金	提供額外端午、中秋、年終獎金，以保障基本薪資。
員工持股	庫藏股、限制性股票	提供員工認股計畫，激勵關鍵人才留任率。
津貼類	婚喪喜慶禮金	依公司相關公告或規範提供各式津貼類福利措施。
	生育禮金	
	個案重大傷病補助	
	外訓補助	
	碩博士進修獎助計畫 *	
保障類	團體保險	提供員工年度團體保險，保障意外傷害發生風險。
	出差旅平險	提供國外出差員工旅平險，保障意外傷害發生風險。
	勞工新制退休金提撥及舊制退休金提繳 *	與法規福利相同。（僅一位員工舊制，其餘員工皆新制）
假期類	彈休假 *	雖勞基法施行細則修訂後國定假日縮減 12 天，惟仍額外提供 7 天彈休假。
	健檢假	提供參加公司健檢之同仁，當天可使用健檢假一天。
活動類	不定期部門活動	提供多元員工活動，凝聚同仁歸屬感與參與感。
	不定期員工旅遊	
	年度尾牙及抽獎	
	新產品 Release Party	

註：適用範疇為台灣與中國大陸；「*」僅適用台灣；美國據點相關福利則依據當地法規規定。

3-7 產品生命週期管理

揭露主題：產品生命週期管理

指標編號	指標項目	說明
TC-SC-410a.1	含有 IEC 62474 宣告物質的產品其銷售金額百分比	來頡科技以 RoHS、REACH 之管制化學品清單為依循重點，報導期間內比對 IEC 62474 與上述兩項規範之差異，現有出貨之產品皆無使用 IEC 62474 所應宣告之物質。截至 2024 年底，尚無客戶以 IEC 62474 之化學品管理標準要求來頡科技提供相關資訊。
TC-SC-410a.2	在系統層級的處理器能源效率 (1) 伺服器 (2) 桌上型電腦 (3) 筆記型電腦	來頡科技之產品未應用於商用主機與個人電腦，因此不適用本揭露指標。

國家 / 客戶	環境限用物質之管制要求
歐盟	RoHS 2.0 指令 (2015/863/EU) 之物質
	包材指令 (94/62/EC) 中附錄之 Pb/Cd/Cr6+/Hg 類之物質
	Dimethyl Fumarate 規範指令 (2009/251/EC) 中附錄之 DMF 類之物質
國際電工委員會	IEC 61249-2-1 無鹵 (Halogen-Free) 之危險物質
	IEC 62474 SVHC 之高度關切物質清單
美國	無 PFAS 採購法案之物質
	加州 65 法案之有毒物質管制清單
	毒性物質控制法案 (TSCA) 之物質
中國	GB- 揮發性有機物 (VOCs) 標準 (GB 30981-2020) 之物質
斯德哥爾摩公約	持久性有機汙染物法規 (EU POPs) 之物質

有害物質管理

源頭管理

來頡科技產品之材料使用遵循國際法規、環保趨勢與客戶要求等，並透過「環境限用物質管理辦法」管理機制，確保來頡產品 100% 符合環境限用物質管制要求。來頡實驗室進行之鉛錒錫作業，為產品測試目的，僅使用極少量的含鉛錒膏，且符合最低容許濃度規範。此外，來頡科技每年依循 IEC 62474 標準中的 SVHC 清單，委託外面實驗室進行部分產品 Reach & SVHC 檢測，以監控晶圓與委外加工供應商之管控作業。

同業合作

來頡科技每年要求與原物料 (晶圓) 與委外加工類型供應商，提供產品有害物質檢測報告，以做產品品質之監控，且亦簽訂「環保限用物質保證書」，回簽率 100%。

因應計畫

因應歐盟與美國近年於全氟與多氟烷基物質 (PFAS) 關注，由於 PFAS 具有致癌且在環境中持久不易分解之特性，企業應更謹慎使用。然而，多氟化合物由於性質穩定，特性優良之優勢，因此普遍應用在電子產品。

來頡科技已於 2024 年啟動盤查，透過蒐集詳細資訊、加強與上游原料供應商溝通，目前掌握部分供應商現行使用的封裝材料 (Die Bond Epoxy) 含有 PFAS；我們持續關注此關鍵物質，產品逐步擴大導入採用不含 PFAS 之封裝材料，落實環境永續。

3-8 原物料採購

揭露主題：原物料採購

指標編號	指標項目	說明
TC-SC-440a.1	描述關鍵原物料使用的風險管理	來頡科技主要原物料中之晶圓為 100% 委外由晶圓代工廠進行製造，稀土金屬為晶圓代工廠之關鍵原物料，晶圓代工廠之供貨穩定度與交期即時性為公司持續關注之採購風險議題，持續透過定期的供應商評鑑，掌握與管理供應商風險情形。

指標編號	尋找新供應商與基本資料建立	書面審核	實際工程試產	評鑑	合格供應商
評估方式	透過網路、報章雜誌、工商業名錄找尋或同業、客戶、其他供應商推薦。	檢視廠商回填基本資料、供應商調查表、社會責任宣導函。	製程評鑑：依新產品驗證、試產、量產管理辦法與供應商工程評估管理辦法執行。	- 依供應商稽核管理辦法與供應商管理程序執行。 - 透過電話、視訊會議，以及書面評鑑或實地稽核，視時視地擇一方式進行評鑑。	評鑑通過後成為合格供應商。
權責單位	採購、生管	採購、工程、品保、生管	工程、品保、生管	工程、品保、生管	採購

原物料風險管理

因全球經貿情勢變化，客戶要求來頡科技及合作對象不得涉及美國實體清單內企業。為確保供應鏈穩定性、採購成本及交期穩定性等因素，來頡自 2023 年起針對晶圓廠、封裝測試廠積極開發新供應商，並於 2024 年陸續完成供應商部署，以降低原物料風險衝擊、滿足客戶需求並降低營運損失風險。

供應鏈管理機制

供應商概況

來頡科技處於半導體產業鏈中最前端的晶片設計，後端的原物料採購、代工製造、封裝與測試等環節皆交由供應商執行，透過專業分工與夥伴合作提升生產效率。

供應商主要分為 3 大類，包含原物料類（如：晶圓、光罩、外購晶圓）、委外加工類（如凸塊、研磨切割、封裝、測試）以及一般供應商（零配件、儀器、庶務類等）。供應鏈管理成效對來頡至關重要，為未來面對企業營運風險首要挑戰，我們將積極與供應鏈夥伴共同落實永續發展。

新供應商管理

來頡科技依據供應商管理程序進行新供應商遴選與評鑑，透過品質系統問卷進行調查，供應商之公司概況、材料、製程、產能、品質工程、交期、價格、服務等項目，亦於遴選及評鑑過程請新供應商簽署社會責任宣導函，確保來頡找尋最合適之供應商。

既有供應商管理

來頡科技依據供應商管理程序，每年定期針對合格供應商進行供應商評比，其中，依據來頡產品生產製造的分類，對象區分為原物料供應商（含外購晶圓供應商）、委外加工供應商。其評比內容綜合而言，包括品質工程（產品／技術）、交期、服務及價格等面向，並依據其評定結果，區分為 A、B、C、D（優先合格、合格、有條件承認、取消合格）等四個等級。

針對需年度稽核之供應商則依據供應商稽核管理辦法，至實地稽核前，請供應商回覆評鑑自評表，評鑑內容涵蓋品質系統、製程管控、研發設計管控、供應商管理、產品追溯、檢驗機制、綠色產品管控、社會責任等 14 項稽核項目，其稽核結果區分為 A、B、C 等級，若為 C 級，來頡將停止與供應商合作，需重新通過認證方可持續合作。

此外，來頡科技與所有供應商簽訂社會企業責任宣導函（內容與 RBA 相似），2024 年簽署率 100%。

管理對象	管理方式		頻率	結果
	評比	稽核		
原物料類 (含外購晶圓供應商)	V		每年一次	合格
委外加工類	V	V	每年定期及視情況不定期進行	合格

註 1：當年度有交易的供應商均須納入供應商管理；上一年度供應商評鑑得分達 A 等級，當年度可以免除稽核。

註 2：一般供應商如儀器則採驗收流程、零配件購自於通路商，不進行年度評比與稽核。

稽核方式		2024
實地稽核	預計實地稽核家數	7
	實際實地稽核家數	7
	達成率	100%
	新供應商稽核家數	3
書面審核	預計書面稽核家數	1
	實際書面稽核家數	1
	達成率	100%
	新供應商稽核家數	0

來頡科技 2024 年合作之原物料（含外購晶圓）及委外加工等供應商共計 20 家，其中 17 家供應商通過 ISO 14001 環境管理系統驗證，占比 85%。來頡科技針對未通過驗證之其餘 3 間進行風險評估，檢視是否對環境具有潛在負面衝擊。經鑑別後確認 3 間供應商皆無重大實際或潛在負面環境衝擊。

衝突礦產管理

來頡科技針對晶圓、委外加工供應商，所使用礦產的供應商，要求每年回饋衝突礦產調查表 (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT)，提供產品的原料來源與追溯資料，杜絕具衝突礦產原料投入產品使用，經調查後確認 2024 年來頡科技 100% 來自於合格冶煉廠。

礦產種類	指標項目
金 Au	46 家
錫 Tin	26 家
鎢 Tungsten	11 家



在地採購

2024 年來頡科技於亞洲 (不含台灣) 的原物料在地採購占整體採購金額約 92.64%，而來自台灣本地 (註冊於台灣的廠商) 的採購比率則約為 7.36%。未來，我們將持續依據全球市場的供需變化，靈活調整採購區域與金額分配，以確保供應穩定並維持品質水準。同時，亦將持續深化與供應商的合作關係，打造互信互利的夥伴模式。

3-9

智慧財產權保護與競爭行為

指標編號	指標項目	2022 年	2023 年	2024 年
TC-SC-520a.1	因反競爭行為違反相關法規之事件所造成的損失總金額 (單位：新台幣)	0	0	0

為確保公司創新成果受到妥善保護，提升市場競爭力，來頡科技在營業秘密保護與專利管理等方面進行周密規劃與積極推動，並規劃 2026 年前制定「智慧財產權辦法」，以完善智慧財產權管理機制。2024 年針對全公司研發相關人員進行智慧財產權教育訓練，受訓率 90%。規劃 2026 年前召開營業秘密教育訓練。

營業秘密管理

來頡科技依據「機密資訊管理規範」、「電腦系統安全管理辦法」及「資訊安全政策」，保護營運所涉及的營業秘密，且明確界定不同屬性機密資訊的範疇。根據機密等級建立相應的資安維護措施，例如針對設計檔案、客戶名單等重要營業秘密，採取網路隔離措施等安全機制。此外，員工入職時將接受營業秘密管理培訓，且於勞動契約中簽訂關於智慧財產權及保密義務之相關規範，離職時需簽署離職聲明書，以確保離職員工持續履行保密義務。

專利管理

專案管理流程

為確保專利管理之專業性和完善的法律保護，來頡透過外部專利律師事務所協助管理公司的專利事項。

1. 專利內部申請	2. 專利內部申請評估	3. 專利申請與維護
專利申請內部報告，包括專利申請內容、圖表以及發明人資訊。	由相關技術人員進行報告分析與評估，確認內容適宜性與判斷是否申請。	遞交專利律師事務所處理專利書寫、申請以及維護事宜。

技術創新推動

充分賦權員工

來頡充分賦權給員工，提供資源與支持，鼓勵技術創新，激發創意並提升競爭力。

鼓勵創新制度

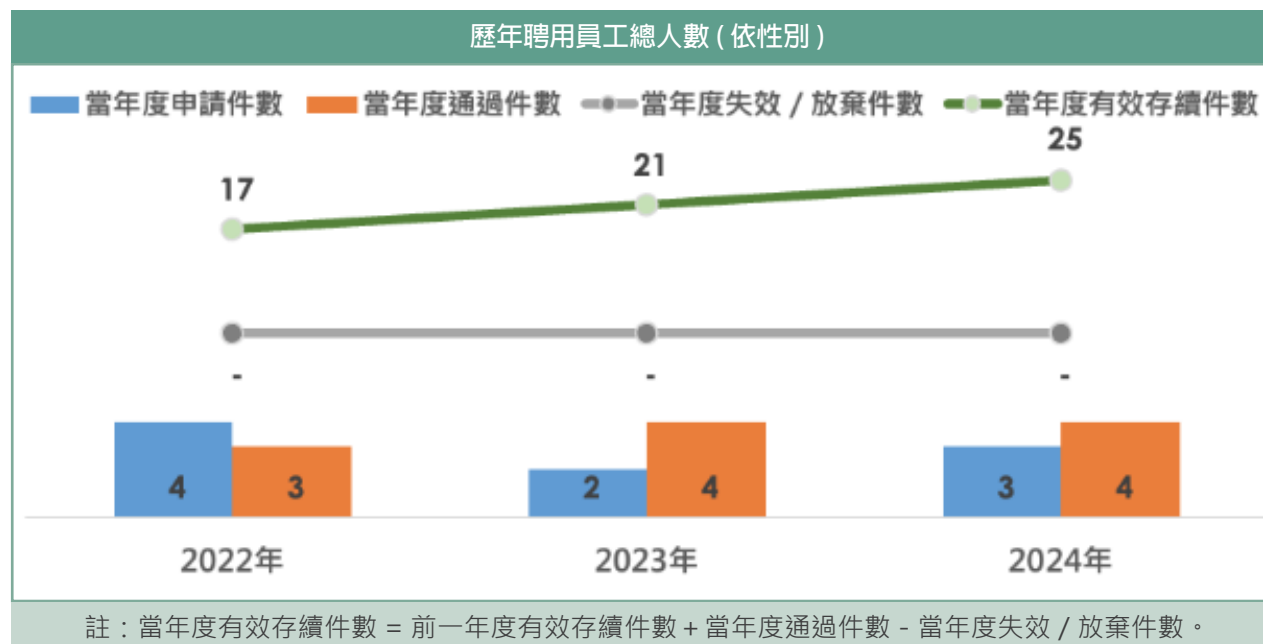
來頡訂有創新相關的內部獎勵機制，鼓勵員工研發創新，提供獎金與晉升機會，提升公司產業競爭力。同時，針對研發部門的技術創新、工作效率提升流程創新或改善，皆會給予鼓勵表揚。

專業培訓

不定期各部門員工進行專業技術培訓。

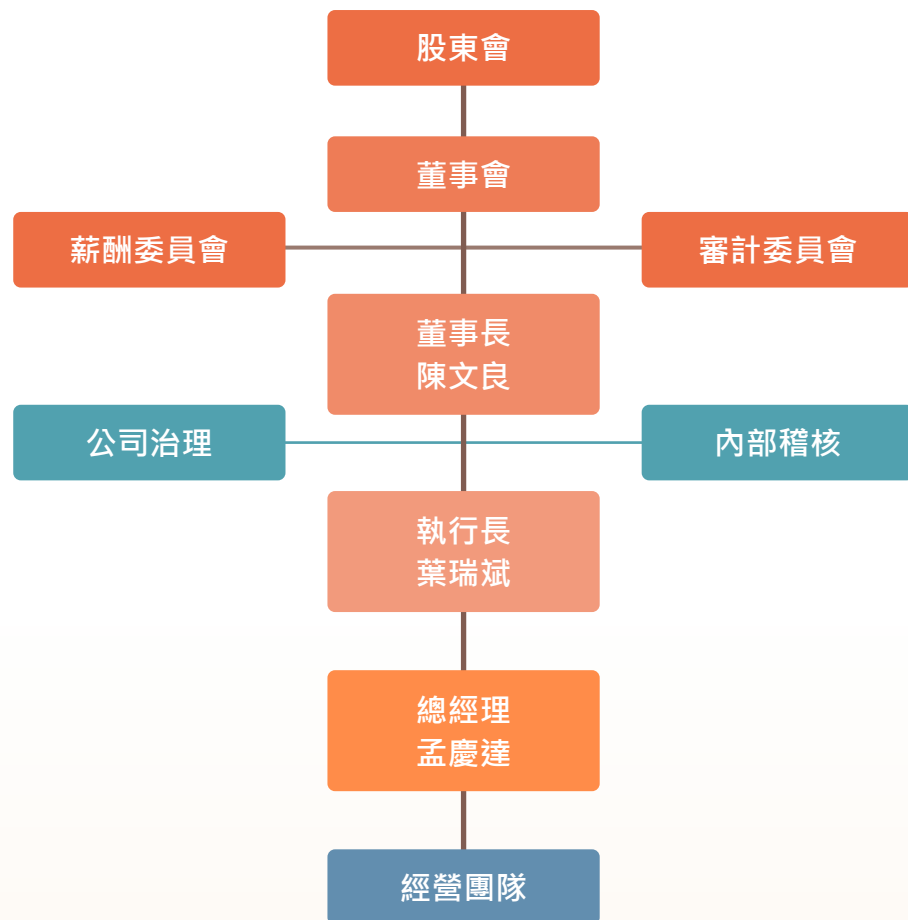
專利統計

來頡科技截至 2024 年止，共計已獲得 25 項發明專利，其中包含台灣 9 項，美國 10 項，中國 6 項。



商標形式及類別	2024 年以 M3TEK 圖樣申請 09 類 (IC 產品相關) 及 42 類 (設計服務相關) 商標。
申請地區	2024 年：台灣、中國、歐盟、日本、韓國、越南。 2025 年：預計申請美國、土耳其、印度。

4-1 公司治理



董事會組成與運作

董事會為來頡科技最高治理單位，下設審計委員會、薪資報酬委員會。董事會依據相關法規及股東會決議履行職責，董事具備執行業務所需的專業知識、技能與素養，並秉持永續經營的原則，致力為股東創造最大利益。其核心職責包括確保公司資訊透明並遵循法規、任命高層經營團隊、規劃盈餘分配方案，以及監督與指導公司營運等。來頡科技已訂定「董事選任程序」，以公平、公正、公開方式鼓勵股東參與董事提名與選任，且依公司法及相關法規規定，董事選舉採候選人提名制度及累積投票制，其董事之選任應考慮董事會整體配置，成員組成應多元化，且就運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針（如性別、年齡、國籍等）及專業知識技能（如專業背景、技能及產業經驗等）。

來頡科技最高治理單位主席為董事長，負責決定公司營運策略方向，並定期評估內部控制制度之必要性及合理性，以確保公司治理之有效運作與風險控管機制之健全。

2024 年來頡科技現任董事會由 8 位董事組成，其中包含 3 位獨立董事及 5 位非獨立董事。獨立董事占董事會比例達 37.5%，提前優於金管會上市櫃公司永續發展行動方案要求。所有董事均為產學界的賢達，具備豐富的專業知識與經驗。目前董事會成員皆為男性，占全體董事比例 100%。來頡致力於提升董事會的多元性與性別平衡，正積極尋找合適的女性董事，將綜合考量產業特性、專業能力及公司治理等作為未來選任女性董事之原則，來頡擬定 2026 年至少增設一席女性董事的目標，朝董事會性別多元化目標邁進。

多元化 核心董事姓名	基本組成						產業經驗								專業能力		
	性別	年齡	具有 員工身分	獨立董事任期			電子 產業	半導體 產業	創業 投資	財務與 管理	行銷與 推廣	資訊與 科技	證券 金融	工程與 系統科學	電子	電機	會計
				3 年以下	3 年 ~9 年	9 年以上											
愛普科技 股份有限公司 代表人：陳文良	男	A		(一般董事，不適用)			V	V	V	V	V	V		V	V		
陳燦榮	男	B					V	V	V	V					V	V	
孟慶達	男	A	V				V	V		O		O			V	V	
聯陽半導體 股份有限公司 代表人：林秀哲	男	A					V	V	V						V		
洪維澤	男	A					V	V	V						V		
江志烽	男	A			V		O	O		V			V				V
畢祖明	男	A			V		V		V	V		O	O		O	O	O
彭協如	男	A		V				V	O	V							V

註 1：來頡科技第五屆董事會任期為 2023 年 05 月 24 日至 2026 年 05 月 23 日。

註 2：董事年齡，A：60 歲以下、B：60 歲以上。

註 3：V 係指具有能力、O 係指具有部分能力。

董事會每季定期監管公司在永續發展方面進展，根據報告案進行必要的審議，並對策略實施提出指導意見。來頡科技推動永續相關執行管理進度，2024 年共 5 次報告案 / 討論案經董事會通過。

2024 年	呈報董事會議案
02.29	[報告案] 公司及子公司溫室氣體盤查及查證作業季度執行進度報告案。
05.02	[報告案] 公司及子公司溫室氣體盤查及查證作業季度執行進度報告案。
07.30	[報告案] 公司及子公司溫室氣體盤查及查證作業季度執行進度報告案。
10.29	[報告案] 公司及子公司永續報告書 (含溫室氣體盤查與查證作業) 季度執行進度報告。
12.26	[討論案] 公司民國 114 年度內部稽核計畫案，並依風險評估結果及法令規定應執行項目 (含永續資訊之管理) 。 [討論案] 因應金管會規定將永續資訊管理納入內部控制制度，新增「永續資訊管理作業程序」、「永續報告書編製及確信作業程序」。

來頡科技持續依據相關法規要求，強化董事會職能、提高資訊透明度，提升企業永續價值，促進永續經營。

審計委員會	- 審計委員會全數由獨立董事組成，負有監督財務報導流程之責任，以有效監督內部控制、檢查財務報告。 2024 年開會 7 次，出席率達 100%。
薪資報酬委員會	- 薪資報酬委員會全數由獨立董事組成，且明訂組織規章，監督董事及經理人薪資報酬制度，忠實履行職權並提案董事會審議。 2024 年開會 5 次，出席率達 100%。

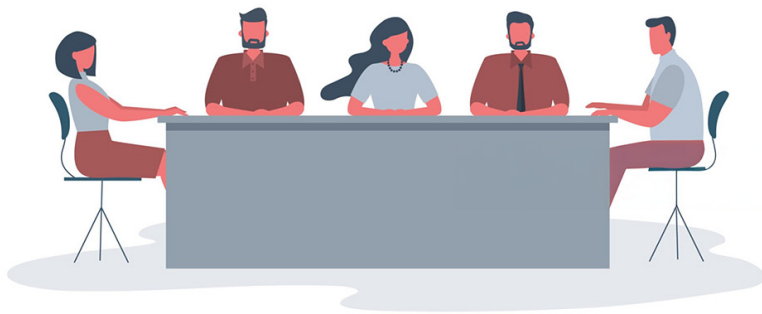
董事會績效評估

來頡科技訂定「董事會績效評估辦法」定期評估董事會及功能性委員會，每年執行一次內部董事會績效評估，且應至少每三年一次由外部機構執行績效評估，其評估結果可做為董事提名續任之參考。

2023 年委託外部機構財團法人中華公司治理協會，執行 2023 年度董事會績效評估。中華公司治理協會為獨立、專業的董事會績效評估機構，分別就董事會組成、董事會指導、董事會授權、董事會監督、董事會溝通、內部控制及風險管理、董事會自律及其他等 8 大構面，採線上開放式問卷填答與視訊訪談（與董事長、總經理、審計委員會召集人、薪酬委員會召集人、公司治理主管、內部稽核主管訪談）之方式進行評核，並於 2024 年 1 月提出評估報告，其董事會及各功能性委員會整體評估結果為「運作良好」，並呈送 2024 年 2 月 29 日董事會報告。詳見 2024 年年報「公司治理運作情形」。

董事 ESG 進修

來頡科技為協助董事執行監督管理所需之法遵、產業新知與 ESG 趨勢等，2024 年度董事進修時數共計 54 小時。董事進修情形，請參閱 2024 年年報。



關鍵議題溝通

來頡科技管理階層亦定期報告關鍵重大事件（涵蓋財務風險、ESG、資訊安全、誠信經營、內稽內控等）及相關資訊提供董事，包含法規遵循、國際情勢變動、每季度之財務報告及內部稽核報告等。董事會每年針對各利害關係人權益，訂定出各項重大策略，提供永續管理的重要指導方針。2024 年關鍵議題溝通次數，共計 9 次董事會、7 次審計委員會，請詳閱 2024 年年報「董事會運作情形」及「審計委員會運作情形」。

利益衝突

來頡科技董事、經理人及其他出席或列席董事會或委員會之利害關係人對會議所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

此外，針對與利害關係人之交叉持股、控制力股東的存在、關係人交易等資訊，皆於年報中進行揭露，以避免或減緩利益衝突之可能性。2024 年 3 件利益迴避案件，請詳 2024 年年報「公司治理運作情形」。

治理階層薪酬政策

來頡科技設有薪酬委員會，負責協助董事會評估整體薪酬與福利政策，並制定董事及經理人的報酬與績效評估標準。

董事依據公司章程第二十五條規定，若公司年度總決算有盈餘，則應提撥不高於 2% 作為董事酬勞，董事酬勞將參考董事對營運的參與程度、貢獻價值及出席率進行分配；獨立董事不論公司營業盈虧，執行公司職務時，公司將依董事會決議支付定額報酬，該定額報酬與公司績效無關，不隨績效變動。此外，公司董事與獨立董事出席董事會或股東會可領取車馬費每次新台幣 3,000 元，若因營運需求出差者，亦可依公司規定申請補助。

高階薪酬

來頡科技高階經理人包含執行長、總經理、副總經理及經理人，其整體薪酬結構依「經理人薪資酬勞管理辦法」辦理，涵蓋固定薪資、變動薪資、酬勞、股權激勵與福利，以體恤及獎勵經理人於工作上的努力付出。其中，變動薪資與獎勵部分，依據公司年度經營績效、財務狀況、營運成果及個人工作績效進行核給，並參考同業水準，確保薪酬合理性與市場競爭力。

變動獎勵主要以年度績效獎金為實現方式，評估標準包括個人績效、團隊目標達成情形，以及公司整體營運與獲利表現，使績效表現與薪酬發放相符，進而帶動公司穩健經營與持續成長。

酬金政策由薪資報酬委員會根據前述指標提出合理建議，並提報董事會審議通過。經理人之績效評核，則依「經理人績效管理辦法」執行，作為獎勵核發的依據。其中，執行長與總經理之績效指標分為財務性指標及非財務性指標兩大類，財務性指標與整體公司成長獲利表現相關；非財務性指標涵蓋策略規劃、組織管理、風險控管、研發創新等面向，與公司永續長期發展密切相關。

2024 年總經理之全年總薪酬與員工全年總薪酬之中位數（排除總經理），其薪酬之比率為 3.52 倍；另分析員工之薪酬成長百分比，以台灣來頡於 2024 年及 2023 年皆在職之員工，計算其兩年度薪酬成長百分比後，進行排序取其中位數，總經理薪酬成長百分比與員工薪酬成長百分比中位數（排除總經理）之比率為 0.86 倍。前述之薪酬包含基本月薪及變動獎金（不含員工認股權、RSA、庫藏股等）。

內部稽核

來頡科技內部稽核係依據內部控制制度執行，依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，對於發現之內部控制制度缺失及異常提出改善建議，作成稽核報告，每季定期向審計委員會及董事會報告，以確保各項制度之設計及執行持續有效。依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第 8 條規定，上市櫃公司應將永續資訊之管理納入內部控制制度。因此，修改內部控制制度及新增作業辦法，將永續資訊之管理納入 2025 年度內部稽核計畫中，並提報 2024 年 12 月 26 日董事會通過。日後將依照時程進行查核，確保永續發展相關資料的揭露符合法規要求。

此外，每年督促內部各單位及子公司定期自行評估各項控制作業設計及執行的有效性，再由內部稽核單位覆核，依據檢查結果，做為公司出具內部控制制度聲明書依據。



法規遵循

為確保營運符合法律規範並保障股東權益，來頡科技法遵管理機制，最高管理權責由董事會負責整體監督公司對所有適用法律法規的遵循情況，範圍涵蓋《公司法》、《證券交易法》、《勞動基準法》等相關規範，確保公司營運合法合規。

公司規劃於 2026 年設立專職法遵部門，以統籌並執行各項法規遵循工作，確保日常營運符合法律要求，並適時向高層管理階層報告。該部門將定期為管理階層及員工提供法遵培訓，以提升全體員工的法規意識，使其將公司的法遵文化落實於日常業務。

此外，內部稽核部門依照稽核計畫查核公司的法遵狀況，並向董事會報告執行情形，以合理確保公司相關法令規章之遵循，確保內部控制制度設計及執行有效。來頡透過董事會、內部稽核與未來將設立的法務部門的相互配合，優化健全的法遵管理體系，確保長期穩健發展。

來頡科技 2023 年至 2024 年末有重大違反利益衝突、貪腐、洗錢、內線交易、產品安全等裁罰案件及重大違反環保、勞工、重大職業災害的紀錄。然而，2024 年有 8 筆與稅務申報相關的裁罰，金額共 61,500 元，均已由權責單位納入管理且設立改善措施。

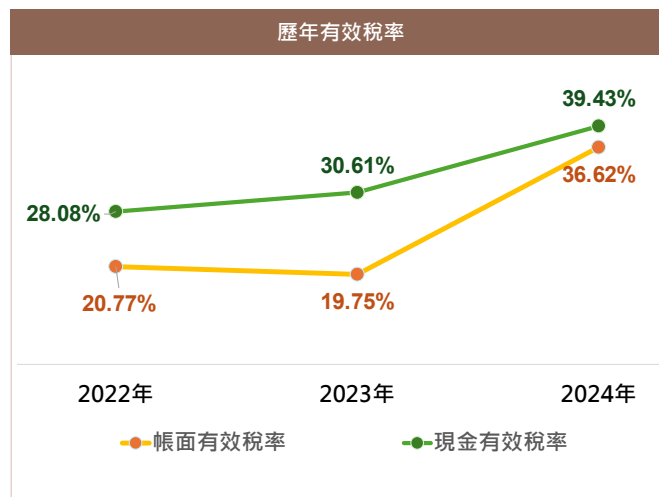
年度	類別	項目	改善措施
2024	經濟	- 違反所得稅法第 89 條第 3 項，裁罰新台幣 750 元之罰鍰，共二筆。 - 違反所得稅法第 92 條，裁罰新台幣 10,000 元之罰鍰，共六筆。	加強相關人員教育訓練
2023	經濟	違反所得稅法第 89 條第 3 項，裁罰新台幣 750 元之罰鍰，共一筆。	加強相關人員教育訓練
註：重大違反法規定義為單一事件罰鍰金額累計達新台幣 100 萬元以上。 註：統計以罰鍰支付年度計算。			

4-2 稅務治理

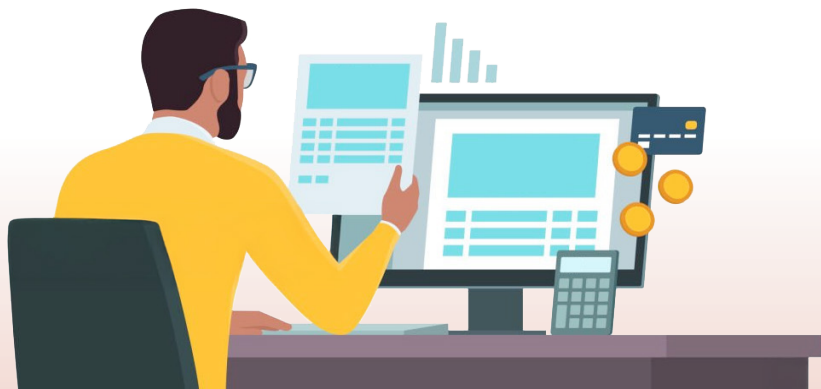
管理原則

來頡科技秉持合法合規的稅務治理原則，關注營運據點所在地區稅務法規的變動及其可能產生的稅務風險。稅務管理單位為財會中心，履行公司各項稅務義務，相關稅務揭露資訊遵循財務報導準則及相關規定。此外，來頡科技亦透過委任或諮詢外部稅務專家，藉由其專業的服務，強化稅務知識，確保稅務合規性並嚴格遵循申報義務。

繳稅情形



有效稅率	單位：新台幣仟元		
年度	2022 年	2023 年	2024 年
稅前淨利 (A)	373,614	272,232	191,805
所得稅費用 (B)	77,595	53,756	70,247
支付之所得稅 (C)	104,895	83,338	75,622
帳面有效稅率 = (B) ÷ (A)	20.77%	19.75%	36.62%
現金有效稅率 = (C) ÷ (A)	28.08%	30.61%	39.43%



4-3 誠信經營

來頡科技以誠信經營為企業核心價值，秉持誠信正直原則從事所有業務活動，對貪腐、賄賂、內線交易等違反商業道德行為採取零容忍態度。來頡科技參酌「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂有「道德行為準則」、「誠信經營守則」以及「誠信經營作業程序及行為指南」，並經董事會決議通過，董事會與高階管理階層依循法令執行管理規章。其中，「誠信經營作業程序及行為指南」已明確規範作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並確實執行相關制度，亦定期檢討及修正前揭規範，以持續強化誠信治理之落實。本公司於 2024 年並無違反誠信經營相關守則與規章之紀錄。

我們 2024 年增訂「吹哨者管理辦法」，建立舉報機制與檢舉管道，並同步揭露於官網，針對被檢舉對象我們將指派適當之受理單位，並依循管理辦法進行適宜的保護與處理。此外，來頡科技規劃 2025 年針對全體員工進行誠信經營教育訓練與宣導課程。

- 吹哨者信箱：whistleblower@m3tekic.com
- 2024 年無舉報紀錄。

2024 年誠信經營教育訓練	對象	參與率
內線交易	全體員工	100%



4-4 創新管理

創新管理方針

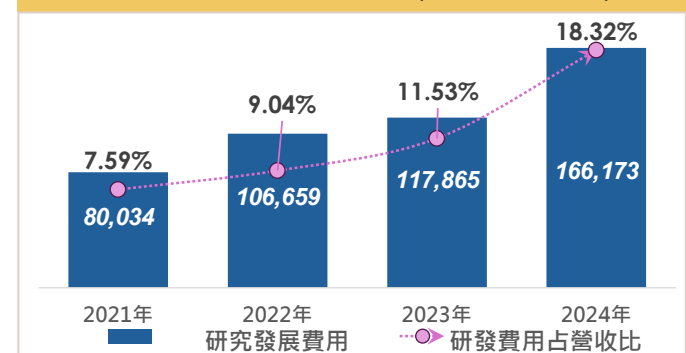
來頡科技創新之核心目標是為客戶創造價值，解決實際問題。創新點的發掘源於對客戶需求的深入理解，從客戶的角度出發，洞察其所處情境與面臨的挑戰，並結合技術與市場發展趨勢，預測未來需求，有助於開拓新的應用發展與領域，公司透過創新發明來驅動價值創造。

為實現技術創新公司持續與客戶交流，蒐集並分析市場調研、競爭態勢及新興技術發展等多方面資訊，從而制定可行且具長遠價值的技術研發路徑，並確立技術研發指標。此外，透過內部技術交流與產品定位，確保研發人員深刻理解技術路徑與發展目標，並在充分賦能每個研發環節的基礎上，推動有價值的技術創新。

來頡科技重視創新研發能力，透過五大方針鼓勵創新能量，以達成公司產品或服務的技術創新

- 智慧財產權管理：透過外部專利律師事務所來有效率的協助公司知識財產權管理。
- 產學合作：與台灣、美國以及中國的大專院校合作，瞭解與掌握最新技術發展。
- 人才培育：每月舉行一次技術研討和交流會議，針對電源管理技術、市場應用分析、相關技術領域基本介紹等面向，以提高研發人員的研發能力。
- 創新獎勵機制：每季提報名單，並給予獎金獎勵。
- 研發投入：2024 年研究發展費用投入逾 1.66 億元，占營收 18.32%。

歷年研發投入費用與佔營收百分比 (單位：新台幣仟元)



MT8351 超低待機功號降壓轉換器

榮獲 EE Product Awards Asia

2024 年亞洲金選年度最佳電源半導體產品獎

來頡科技新產品開發技術再度得獎，獲得電子工程專業人士肯定

產品永續設計

來頡科技關注產品生命週期，從產品設計、製造、包材、運籌、高效使用等階段，如考量設計時對環境的友善性、採用對環境友善原料、產品包裝減量或回收、提升運輸效率等面向，持續透過永續設計提升產品競爭力，推動產品永續節能，致力於提供超越客戶期待的產品。



產品設計

結構最佳化

- 功能集成以及系統簡單化：致力於功能集成以及系統簡單化的產品迭代，集中多功能於一個晶片中來達到相同或更好的效果，使 Pin 數減少、體積更小。

更好材料

- 較小封裝尺寸之打線 (Wire bonding) 產品：原以金線作業，後續將採用銅線作業，除了電性上可以符合現有功能外，亦可降低生產成本，且銅在開採時相較於金的環境衝擊較低。

產品安全

- 內部測試：
依照 JEDEC 規範作業，執行產品可靠度測試如溫度循環測試、高溫儲存測試、加速壽命測試、高壓蒸煮測試、老化壽命測試、抗靜電測試、門鎖效應測試等，其測試目的為確保出貨產品在不同環境下能穩定運作外，亦與國際標準之可靠度接軌。
- 外部驗證：
 - » 資通類產品如 UL 62368 / UL 2367 認證，UL 62368 與 UL 2367 均與電子和電源產品安全性相關的標準，這些認證的需求主要來自於法規要求、市場準則、品牌信譽及降低產品責任風險等多方面的考量。
 - » 許多終端設備 (如筆電、伺服器、通訊設備) 必須符合 UL 62368-1 才能進入北美市場，因此電源 IC 供應商若能提供符合 UL 標準的產品，能降低客戶開發成本，增加競爭力。
 - » 若 IC 用於高功率應用 (如工業電源、電信設備)，符合 UL 2367 可提高產品合規性，增加設計導入的機會。
 - » 電源 IC 本身若已經符合 UL 62368-1 或 UL 2367 的要求，那麼終端設備在認證時不需要額外測試該 IC，僅需確認應用方式符合規範，減少客戶的開發時間與測試成本。客戶可以直接將符合 UL 認證的 IC 導入設計，而無需再花時間找替代方案，如此更容易獲得國際大廠的採用。



製造

高效製造

- 代工廠於製程或製造端的機台自動化比例提升：如機台自動化、縮短測試時間、無人搬運車、自動換卷帶等項目，大幅提升生產製造效率。

封裝技術提升

- Flip Chip 覆晶技術封裝：使產品尺寸面積縮小，提高封裝密度，可達輕、薄、短、小的目的，間接減少 PCB 面積。
- 依客戶需求導入 WLSCP 和 2D 封裝：WCSP 為裸晶封裝，為目前最小面積之封裝尺寸；2D 封裝可整合金屬氧化物半導體場效電晶體 (MOSFET) 或電感 (Inductor) 於來頡科技產品中，達到輕、薄、短、小的目的，也間接減少 PCB 面積。



友善包材

包材循環使用

- 紙箱回收重複使用：來頡科技接收供應商出貨，或產品出貨給客戶端，皆回收重複使用。

包材減量

- 產品出貨提高小包箱容積率：可減少紙箱及緩衝包材耗用。



運籌

產品運輸

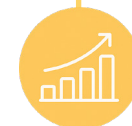
- 視客戶需求，安排集中出貨。



使用階段

高效能產品

- DCDC 電源管理晶片：採用新的系統架構，使靜態電流從上一代產品的 5 μ A 降低至 0.35 μ A，拉長每次充電使用時間，延長電池續航力，減少功耗，降低能源使用。
- 負載開關晶片：透過高度集成化，集成電流採樣和數位介面技術，大幅降低了系統方案外部元件數量和面積（約 40%），降低系統方案成本，提高效率。
- 線性穩壓器：採用創新電路設計，大幅降低高電壓線性穩壓器的靜態電流（10 μ A 降低至接近 1 μ A），降低系統的靜態功耗。
- 儲能管理晶片：
 - » 推出多個超級電容儲能管理晶片，透過集成多項保護功能，達到可靠的超級電容充放電管理以及保護。
 - » 從以往解決方案的 4 至 5 個晶片減少至 1 個晶片的解決方案，大幅減小方案的空間和成本，提高系統工作效率，增加系統待機時間，同時確保超級電容儲能元件安全。



社會貢獻

環境友善

- 低能耗的超級電容可替代鹼性電池、鋰電池，環境友善性佳。

4-5 資安管理

根據 2024 年世界經濟論壇 (WEF) 全球風險報告，前十大風險之「錯誤資訊與假訊息 (Misinformation and disinformation) 」在短期與長期風險分別排序第 1 位及第 5 位；「網路不安全 (Cyber insecurity) 」在短期風險排序則從 2023 年的第 8 位躍升到第 4 位，長期風險仍排序第 8 位。然而，展望未來十年的科技風險尚有新增「AI 技術的不良後果 (Adverse outcomes of AI technologies) 」，並且排序第 6 位。

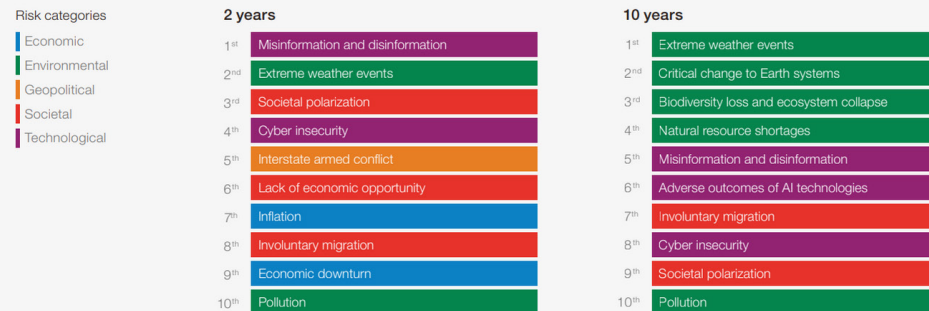
綜觀世界經濟論壇每年發布的全球風險報告，2023 年全球十大風險首次列入資安風險 - 「網路不安全 (Cyber insecurity) 」，顯示企業應更加關注資訊安全風險；2024 年其排序躍升更顯示關切程度與衝擊程度的雙重提高。而新增的兩項資安相關風險，其中「錯誤資訊與假訊息 (Misinformation and disinformation) 」已位居全球風險第一位，並於 2024 年至 2025 年蟬聯第一。

面臨日益複雜的網絡犯罪型態，如隱私權喪失、數據詐欺或資料盜竊等事件，一旦暴露資訊安全防護弱點或漏洞，可能導致資料外洩及勒索風險。嚴重者可能面臨系統中斷，不僅衝擊營運導致損失，更影響商譽。

鑒於資訊安全日趨重要，而網路釣魚行為和攻擊層出不窮，來頡科技納入資訊安全管理於永續治理框架，以確保資訊資產的機密性與可用性，並建立健全的資訊安全管理體系，透過系統化管理確保來頡科技的資訊資產具備安全性與完整性。

FIGURE C Global risks ranked by severity over the short and long term

"Please estimate the likely impact (severity) of the following risks over a 2-year and 10-year period."



Source
World Economic Forum Global Risks
Perception Survey 2023-2024.

資料來源：WEF [《Global Risks Report 2024》](#)

註：短期風險為 2 年內風險；長期風險為 10 年內風險

資訊安全推動小組

來頡科技已設立專責的資訊安全推動小組，且資訊數位部配置一名資安主管，及一名資安專員，針對資安風險管理、系統防護、資安意識宣導，以及資訊安全架構的評估和導入等進行 PDCA 循環（Plan-Do-Check-Act）。來頡科技 2024 年未發生敏感資訊洩露或營運服務中斷之重大資安事件。

資訊安全管理機制

來頡科技依循國際標準 ISO 27001 管理架構與參考金管會「資通安全管控指引」，制定「資訊安全管理政策」，涵蓋資訊資產管理、風險評估、存取控制、事件管理等面向，考量資安政策完整性將隨資安現況進行增修，且於 2024 年發布「資訊資產管理辦法」，同年啟動資訊資產風險評估專案，以降低資安風險，並提升資安韌性。2025 年預計訂定資安通報標準作業流程（SOP），持續精進資安防護網絡。



近年資安管理重點推動項目

2023 年

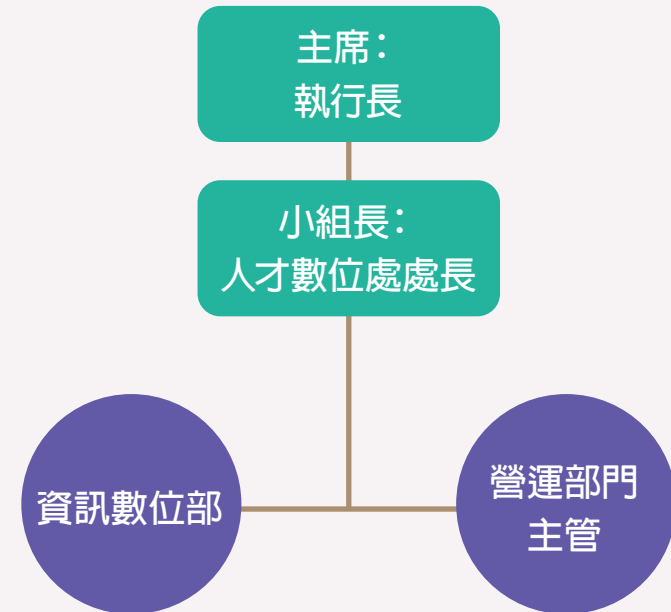
- 啟動資安資產評估：
- 確認目的與範疇
 - 人員與資源投入

2024 年

- 進行完整資產風險評估：
- 資訊資產盤點
 - 使用者定義資訊資產價值
 - 威脅辨識
 - 脆弱性分析

2025 年

- 資訊資產風險管理：
- 風險處置
 - 管理策略
 - 監測與持續改善



資訊管理安全項目

項目	說明
實體安全	實體門禁與實體網路隔離
人員權限管理	- 人員權限管控 - 實體網路分類隔離
硬體防護	- 防火牆 - 第三方 IDC (Internet Data Center) 機房
網路安全	- 端點防護：針對伺服器與個人 PC 與 NB，安裝端點防護系統 (MDR) 優於傳統的防毒軟體，針對行為模式比對，主要針對勒索病毒及程式的異常行為。 - 社交工程：每年 2 次社交工程演練，測試範圍包含開信、連結、開啟附件 2024 年誤觸率：20% 2025 年預計加強宣導，目標將誤觸率降到 5% 以下 - 弱點掃描：每年 1 次
系統安全	異地備份與備援
緊急應變	災難還原演練
安全防護	雙因子驗證
監控機制	網路流量、log 分析、每週確認網路十大風險狀況
教育訓練	- 新進員工：100% 完成資安教育及宣導 - 全體員工： - 線上課程結合測驗：2024 年實施一次，全數通過且完測率 100%。 - 不定期教育宣導：一年超過 12 次的宣導，相關宣導事項製作於網頁後發放信件給同仁參考。 - 資安同仁：自行外部受訓、參加相關議題研討會

4-6 客戶服務

來頡科技客戶服務原則



客戶關係

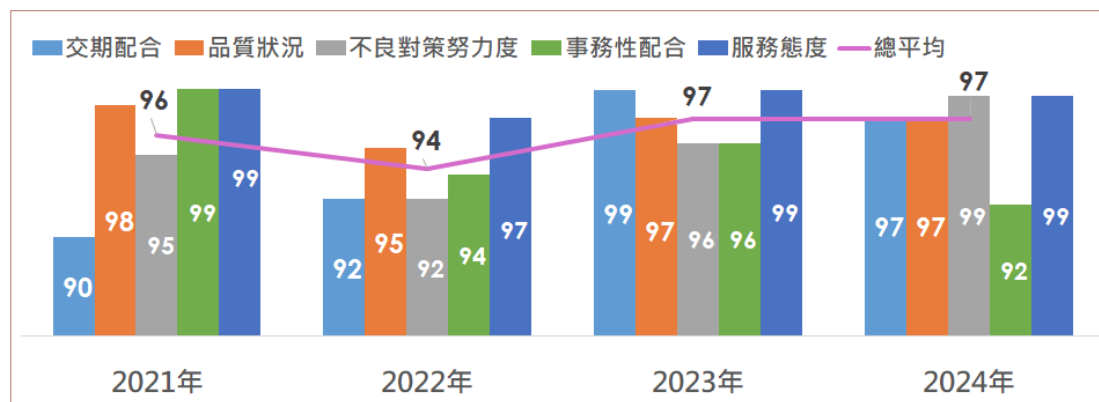
來頡科技專注於提升「研發技術」和「產品品質」，持續發揮供應鏈優勢，滿足客戶期望。一向將客戶視為最重要的策略夥伴，無論於產品開發、設計支援到量產支援，皆依循 ISO 9001 品質管理系統要求，進行流程導向的管理與評核，盡力滿足客戶的需求與期望。來頡科技始終以客戶的角度去思考，協助客戶解決問題，共創雙贏。

來頡科技制定「客戶服務政策」，明確規範管理辦法，定期進行評估與更新，並且設立客戶服務部門，負責客戶關係管理及滿意度調查。其主要管理重點包含：

- (1) 監控客戶回饋，分析數據以了解客戶需求。
- (2) 提供客戶支持，解決問題及回應查詢。

客戶滿意度

來頡科技相當重視客戶意見，每年執行一次客戶滿意度調查，依據營業額前八大已量產的客戶發放問卷調查。2024 年滿意度調查結果顯示，來頡科技整體平均皆達 97 分以上（滿分 100）。

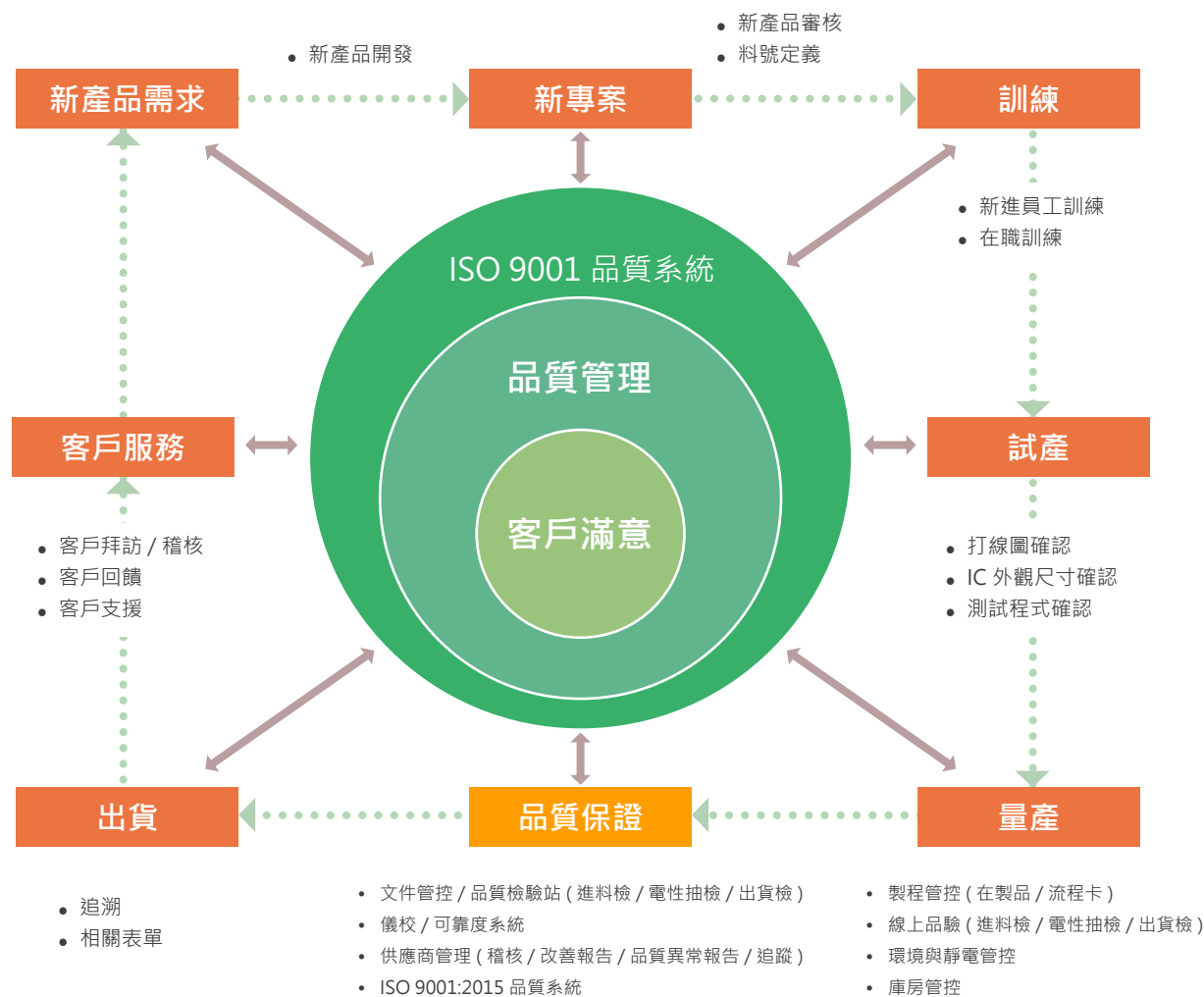


產品品質

來頡科技致力於提供客戶滿意的產品與服務，秉持「革舊、創新、品質第一」的經營理念，扮演客戶的最佳夥伴。我們以「研發與品質」為 IC 設計產業的核心競爭力，來頡科技於 2012 年導入 ISO 9001 品質系統之國際標準並取得驗證，建置完整的品質管理系統，制定品質計畫，並依循 PDCA 方法持續推動改善和優化的善性循環，以提供最佳的產品與服務。

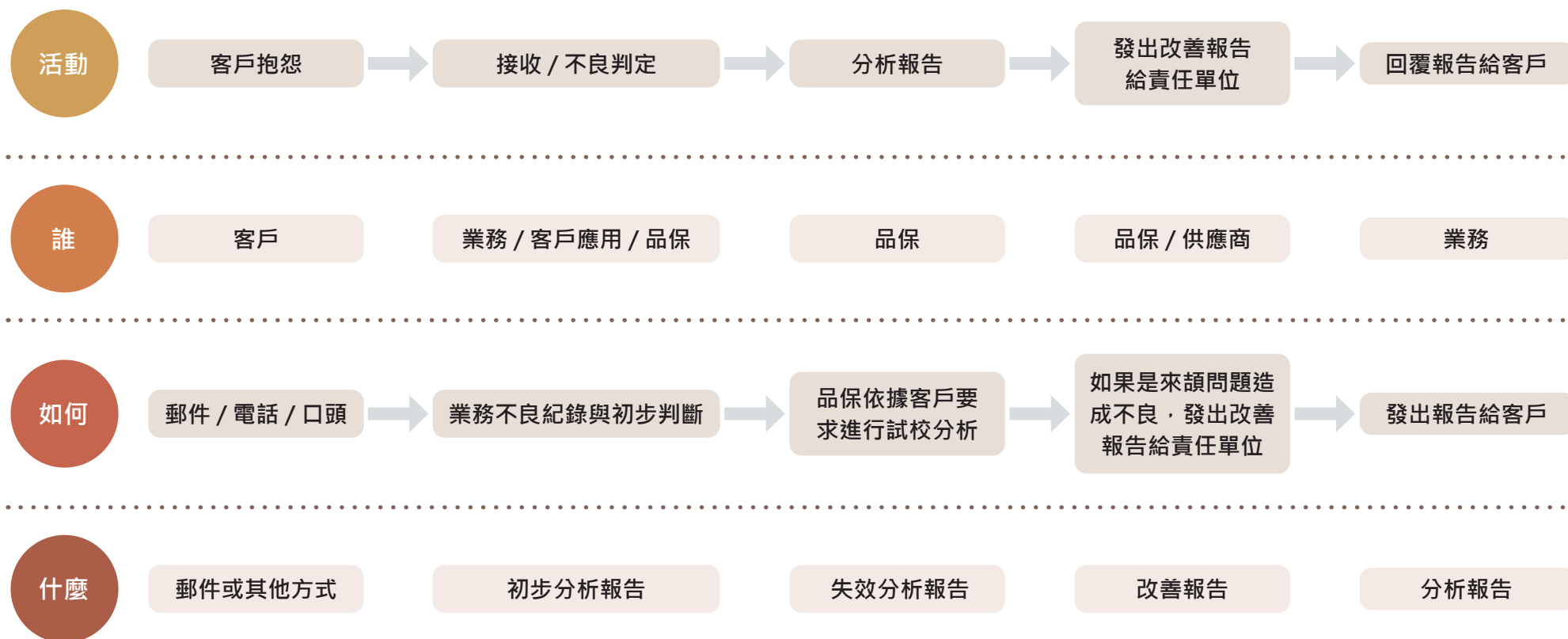
我們依據完整的品質管理系統管制之下，新產品依循 ISO 9001 架構進行研發，從需求蒐集、工程樣品試作、設計驗證、成品等階段，最終通過品質驗證完成產品出貨。此外，為保持生產製造優勢及公司作業系統化，我們也已導入電子商務化的 ERP 系統，隨時掌控產品生產進度。

2024 年品質目標	2024 年達成情形
品管單位 - 初步失效分析報告回覆時間 小於 5 個工作天	3.05 天 (共 39 件)
研發單位 - 完成每年大於 12 件開案件	16 件
生產單位 - 生產單位交期達成率大於 80%	大於 95%



異常管理流程

來頡科技重視客戶回饋，針對異常管理已制定「不合格品管理程序與矯正與預防措施管理程序」，對應權責單位，以清晰掌握處理階段與時效。2024 年品質改善專案立案 12 件，結案 10 件，尚有 2 件持續追蹤管控。



限用物質管理

來頡科技長期關注環境永續相關趨勢與法規，如歐盟的「電子產品有害物質限制指令 (RoHS)」和「化學品註冊、評估、授權和限制法規 (REACH)」等，深知環境有害物質對環境的衝擊與人群健康的危害。來頡自2012年制定「限用物質管理辦法」，並導入供應商認知訓練與稽核。2024年關鍵供應商100%回簽限用物質保證書，每年提出限用物質檢測報告。

持續改善專案

2024 年專案名稱	說明	績效
產品品質良率改善	目的： 現有量產製程，進行生產良率之提升（亦可間接降低成本），相對也減少需要產出之晶片，實現節能減碳，並穩定產品品質。 內容： - 解決供應商之異常。 - 減少生產相同晶片所需之光罩層數。	2024 年完成 10 件（2 件目前仍在追蹤中） - 降低生產異常，相對降低所需之工程、品保與生管人力 - 降低生產週期，達成客戶需求之交期 - 穩定產品品質，減少客戶訴怨

品質教育訓練

員工教育訓練內容亦規劃品質管理課程，並且派員定期外訓，以確保相關同仁在工作中具備最新趨勢與法規的背景知識和認知。

2024 年訓練課程	對象	訓練人次	訓練時數
限用物質教育訓練	品管人員	4 人次	4 小時
電子電器綠色產品法規	品管人員	1 人次	2 小時

5-1 環境政策

來頡科技致力於 IC 設計領域推動環境永續發展

法規遵循

嚴格遵守並超越所有適用的環境法規和標準，確保營運活動符合環保要求。

資源管理

有效管理能源使用，評估適用的節能減碳措施，並透過回收再利用以降低有害廢棄物產生。註

員工參與

鼓勵同仁積極參與外部環境永續培訓課程，並提供相應學習資源補助計畫，同時公司不定期策劃舉辦環境永續活動，促進全體員工環境永續意識提升。

綠色設計

在產品設計階段融入環境永續宗旨，鼓勵產品創新兼具提升能源效率，並確保產品符合 RoHS、REACH 等環保指令。

持續改進

定期審視並改善以上行動方案，持續促進環境永續發展。

供應鏈合作

進行供應商調查並檢視 ISO 14001 環境管理系統認證，確保整個供應鏈的環保責任。



註：廢棄晶圓屬有害廢棄物，來頡科技委託合格廠商進行回收報廢。

5-2 人員發展



教育訓練制度

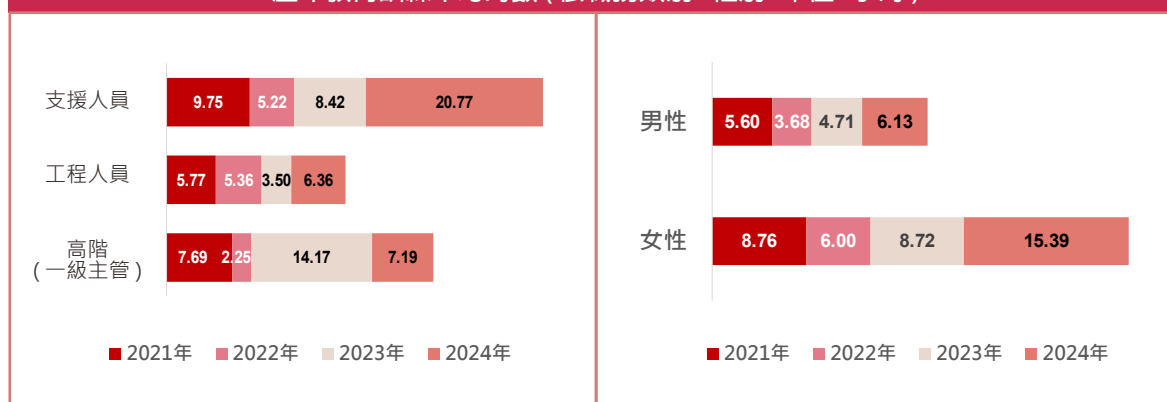
來頡科技每年依據公司願景、組織策略、經營理念、企業文化與員工實際需求，制定年度訓練計畫並依計畫開辦課程。其教育訓練主要區分基礎訓練（新人）、通識訓練（全體員工）、專業職能（技術部門員工）以及管理職能（主管），以強化各職級之專業能力。

訓練推動成果

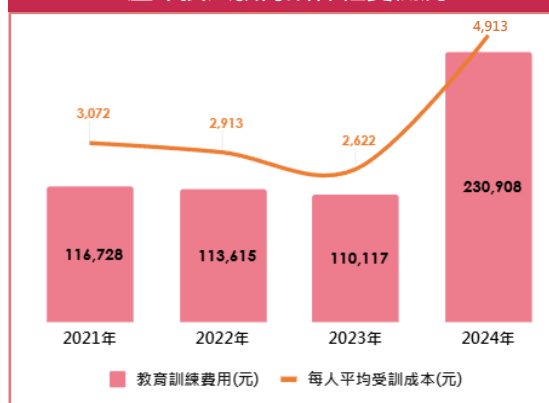
來頡科技深信持續學習是驅動創新的關鍵。我們既有的課程仍持續辦理外，亦提供多元的訓練資源與活動，以協助員工提升專業能力。依據各職級職能需求，我們規劃並提供相應的專業訓練，支持員工全方位發展。

2024 年來頡科技投入教育訓練的經費逾 23 萬元，平均每人受訓成本為 4,913 元；以時數分析，總受訓時數為 464 小時，平均每人受訓時數為 10 小時。顯見 2024 年投入教育訓練的資源符合來頡科技營運成長的需求。

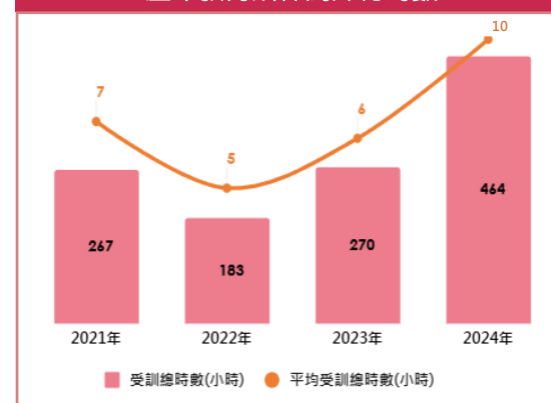
歷年教育訓練平均時數 (依職務類別、性別，單位：小時)



歷年投入教育訓練經費概況



歷年教育訓練開課總時數



類型	對象	2024 年內容	2025 年規劃方向
基礎訓練	新人	• 公司介紹 • 管理規章 • 辦公資訊系統介紹 Microsoft 365 • 資訊安全 1：勒索病毒防疫 • 資訊安全 2：WFH 網路安全要點 • 資訊安全 3：瀏覽器使用安全 • 職業安全宣導 • 綠色產品管理	• 將性平法防治課程納入基礎訓練，防治職場性騷擾及不法侵害意識。
管理職能	主管	• 數位轉型課程 • 業務行銷力課程 • 預算制定教育訓練課程	• 情境管理主管訓練 • 主管性平教育訓練
專業職能	部門員工	• 專業技術職能	• 各項專業技術職能
通識訓練	全體員工	• 基礎認知訓練	• 性別平等教育訓練 • 防範內線教育訓練 • 誠信經營教育訓練

5-3 人權與員工關係

人權管理

來頡科技透過有效的溝通管理機制，瞭解員工需求與想法、提升同仁參與感及歸屬感，創建友善共融的職場環境。為與員工有效溝通並保護其人權免於侵害或負面影響，來頡科技建立員工溝通管道及信箱，使同仁可表達意見；且對申訴者之個人資料及投訴內容採取嚴格保密措施，致力維護申訴者權益。預計於 2026 年前規劃制定人權管理政策。

來頡科技於 2024 年制定

「HR-E-10- 性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」

並向全體員工宣達，2024 年申訴案件 0 件。

此外，我們 2025 年將持續宣導性平法及推動員工教育訓練課程，維護友善職場、打造健康工作環境。

- 申訴專線電話：02-26560961#321、323
- 申訴專用電子信箱：HRHQ@m3tekic.com

2024 年	受訓對象	參與率
性別教育平等法	全體員工 47 人	100%

員工溝通

來頡科技視員工為重要利害關係人，員工更是公司營運成長的核心動能。在日常工作過程，員工與部門主管保持良好的溝通。此外，公司每季舉辦勞資會議與公司會議，定期透過不同主題的會議蒐集員工意見，作為納入政策與計畫的參考。

員工活動

來頡科技透過舉辦多元的員工活動，促進團隊合作、提升員工歸屬感與工作滿意度，活動類型包括不定期部門活動、不定期員工旅遊、年度尾牙、新產品 Release Party。我們藉由部門活動強化團體合作默契與凝聚力，員工旅遊則更能深化跨部門溝通與協力綜效，年度尾牙除年終回饋感謝員工付出外更總結年度成就以展望來年目標，至於新產品 Release Party 則是創新成果發表，激勵

員工跳脫框架持續創新前進。多元的員工活動不僅強化員工對於公司認同與向心力，更進一步朝吸引與留住優秀人才的目標邁進。2024 年舉辦員工活動共計 17 次。

1 次尾牙春酒

4 次新產品 Release Party

12 次部門聚餐



6-1 GRI 索引表

通用準則揭露索引

使用聲明	來頡科技股份有限公司參照 GRI 準則報導 2024/1/1 至 2024/12/31 期間的內容
使用的 GRI 1	GRI 1：基礎 2021
適用的 GRI 行業準則	無

GRI2：一般揭露 2021

指標	揭露項目	報告書對應章節	頁碼	說明
組織及報導實務 The organization and its reporting practices				
2-1	組織詳細資訊	1-1	公司簡介	P.5
2-2	組織永續報導中所包含的實體		關於本報告	P.4
		6-5	數據揭露範疇	P.77
2-3	報導期間、頻率與聯絡人		關於本報告	P.4
2-4	資訊重編			首次發布報告書
2-5	外部保證 / 確信			無經外部保證
活動與工作者 Activities and workers				
2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	1-3	營運概況	P.11
		3-8	原物料採購	P.42
2-7	員工	3-6	招募及管理全球專業人才	P.34
2-8	非員工的工作者			無非員工的工作者

指標	揭露項目	報告書對應章節		頁碼	說明
治理 Governance					
2-9	治理結構與組成	4-1	公司治理	P.47	
2-10	最高治理單位的提名與遴選	4-1	公司治理	P.47	
2-11	最高治理單位的主席	4-1	公司治理	P.47	
2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	4-1	公司治理	P.47	
		2-4	永續議題管理方針	P.23	
2-13	衝擊管理的負責人	2-4	永續議題管理方針	P.23	
2-14	最高治理單位於永續報導的角色		關於本報告	P.4	
2-15	利益衝突	4-1	公司治理	P.47	
2-16	溝通關鍵重大事件	2-2	重要利害關係人議合	P.15	
2-17	最高治理單位的群體智識	4-1	公司治理	P.47	
2-18	最高治理單位的績效評估	4-1	公司治理	P.47	
2-19	薪酬政策	4-1	公司治理	P.47	
2-20	薪酬決定流程	4-1	公司治理	P.47	
2-21	年度總薪酬比率	4-1	公司治理	P.47	
策略、政策與實務 Strategy, policies and practices					
2-22	永續發展策略的聲明		經營者的話	P.3	
2-23	政策承諾（責任商業行為、尊重人權）		經營者的話	P.3	
2-24	納入政策承諾		經營者的話	P.3	其他內容詳見各項議題之管理方針
2-25	補救負面衝擊的程序	5-3	人權與員工關係	P.68	
2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	5-3	人權與員工關係	P.68	
2-27	法規遵循	4-1	公司治理	P.47	
2-28	公協會的會員資格				無參加公協會
利害關係人議合 Stakeholder engagement					
2-29	利害關係人議合方針	2-2	重要利害關係人議合	P.15	
2-30	團體協約				尚未成立工會，因此無簽訂團體協約

GRI3：重大主題 2021

指標	揭露項目	報告書對應章節		頁碼	說明
3-1	決定重大主題的流程	2-3	重大性鑑別與分析	P.16	
3-2	重大主題列表	2-4	永續議題管理方針	P.23	
重大主題 1：創新管理					
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23	
自訂主題					
	能耗、效率	4-4	創新管理	P.55	
重大主題 2：品質管理					
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23	
自訂主題					
	客戶滿意度	4-6	客戶服務	P.61	
重大主題 3：資訊安全					
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23	
	資訊安全	4-5	資安管理	P.58	
重大主題 4：氣候策略					
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23	
GRI 305：排放 2016					
305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放	3-1	溫室氣體排放	P.29	
305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放	3-1	溫室氣體排放	P.29	
305-3	其他間接溫室氣體排放量（範疇三）	3-1	溫室氣體排放	P.29	
305-4	溫室氣體排放密集度	3-1	溫室氣體排放	P.29	

指標	揭露項目	報告書對應章節	頁碼	說明
重大主題 5：人才吸引與留才				
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23
GRI 401：勞雇關係 2016				
401-1	新進員工和離職員工	3-6	招募及管理全球專業人才	P.34
401-2	提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	3-6	招募及管理全球專業人才	P.34
重大主題 6：人力資本發展				
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.24
GRI 404：訓練與教育 2016				
404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5-2	人員發展	P.66
重大主題 7：永續供應鏈				
3-3	重大主題管理	2-4	永續議題管理方針	P.23
GRI 204：採購實務 2016				
204-1	來自當地供應商的採購支出比例	3-8	原物料採購	P.42

自願揭露準則索引

準則	揭露項目	報告書對應章節	頁碼	說明
GRI 200：經濟主題				
GRI 201：經濟績效 2016				
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	1-3	營運概況	P.11
GRI 300：環境主題				
GRI 302：能源 2016				
302-1	組織內部的能源消耗量	3-2	能源管理	P.30
302-3	能源密集度	3-2	能源管理	P.30
GRI 303：水與放流水 2018				
303-3	取水量	3-3	水資源管理	P.31
GRI 400：社會主題				
GRI 402：勞 / 資關係 2016				
402-1	關於營運變化的最短預告期	-	-	- 如有重大營運改變，來頡科技均依勞基法或是當地法令，進行預告與通知

6-2 SASB 索引表

半導體業揭露指標

產業類型：科技與通訊 (Technology and Communications)

產業名稱：半導體 (Semiconductors)

版次：2023 年 12 月

揭露主題	會計指標	指標編號	對應章節
溫室氣體排放	揭露下列溫室氣體排放資訊： (1) 全球溫室氣體總排放量 (範疇一) (2) 來自全氟化合物 (PFCs) 的總排放量	TC-SC-110a.1	3-1 溫室氣體排放
	論述管理範疇一排放量的短中長期策略或計畫、減量目標及其績效分析	TC-SC-110a.2	
製程能源管理	揭露下列能源耗用資訊： (1) 能源總耗用量 (含燃料、電力) (2) 使用電網占總能源耗用之百分比 (3) 使用再生能源占總能源耗用之百分比	TC-SC-130a.1	3-2 能源管理
水資源管理	揭露下列水資源取用資訊： (1) 取水量，自水資源壓力區 (高度與極高) 取水量占總取水量的百分比 (2) 耗水量，自水資源壓力區 (高度與極高) 耗水量占總耗水量的百分比	TC-SC-140a.1	3-3 水資源管理
廢棄物管理	揭露製造過程中產出之有害廢棄物重量，以及其回收百分比。	TC-SC-150a.1	3-4 廢棄物管理
員工健康與安全	論述如何評估、監控與減少員工暴露於有害環境的方法及成果	TC-SC-320a.1	3-5 員工健康與安全
	因違反員工健康與安全法規相關之事件所造成的損失總金額	TC-SC-320a.2	

揭露主題	會計指標	指標編號	對應章節
招募及管理全球專業人才	須取得工作簽證的員工百分比	TC-SC-330a.1	3-6 招募及管理全球專業人才
產品生命週期管理	包含 IEC 62474 宣告物質的產品銷售金額百分比	TC-SC-130a.1	3-7 產品生命週期管理
	在處理器整體系統層面的能源效率： (1) 伺服器、(2) 桌上型電腦、(3) 筆記型電腦	TC-SC-410a.2	
原物料採購	描述關鍵原物料使用的風險管理	TC-SC-440a.1	3-8 原物料採購
智慧財產權保護與競爭行為	因反競爭行為違反相關法規之事件所造成的損失總金額	TC-SC-150a.1	3-9 智慧財產權保護與競爭行為

活動指標	指標編號	對應章節
總生產量	TC-SC-000.A	1-2 產品簡介
從自有廠區生產的百分比	TC-SC-000.B	

6-3 永續揭露指標 - 半導體業

編號	指標	指標編號	年度揭露情形
一	消耗能源總量（十億焦耳・GJ）、外購電力百分比及再生能源使用率（百分比）	量化	• 耗能源總量：634.079 GJ • 外購電力百分比：100 % • 再生能源使用率：0 %
二	總取水量及總耗水量（千立方公尺）	量化	• 總取水量：0.42 千立方公尺 • 總耗水量：0.42 千立方公尺
三	所產生有害廢棄物之重量（公噸）及回收百分比（%）	量化	• 有害廢棄物之重量：0.0716 公噸 • 有害廢棄物回收百分比：100 %
四	說明職業災害類別、人數（數量）及比率	量化	• 2024 年無違反員工健康與安全法規相關之事件
五	產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及電子廢棄物之重量（公噸）以及再循環之百分比（%）	量化	• 產品開發階段進行測試產生之電子廢棄物重量為 0.0716 公噸，主要為廢棄晶圓與 IC。 • 因所有製程皆委外，未產生其他電子廢棄物與再循環使用之方式。
六	與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化	• 主要原物料中之晶圓為 100% 委外由晶圓代工廠進行製造，稀土金屬為晶圓代工廠之關鍵原物料，晶圓代工廠之供貨穩定度與交期即時性為來頡科技持續關注之採購風險議題，持續透過定期供應商評鑑，掌握與管理供應商風險情形。
七	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額（報導貨幣）	量化	• 2024 年無違反反競爭行相關法規之事件
八	依產品類別之主要產品產量	量化	• 355,287（單位：仟個）。

6-4 溫室氣體盤查及確信情形

來頡科技屬資本額 50 億元以下公司，目前屬於自願性揭露溫室氣體排放量。依上市櫃公司永續發展路徑圖規定 2026 年才需揭露母公司個體盤查（2025 年度），來頡科技及早因應並完成 2024 年盤查。本次報告書之溫室氣體排放資訊係依據 GHG Protocol 進行盤查，營運邊界包含範疇一及範疇二，盤查之組織邊界與確信範圍請詳表「組織邊界說明」。

◆ 溫室氣體排放量

排放範圍	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/百萬元)	確信機構	確信情形說明
範疇一	7.7898			2024 年溫室氣體盤查數據為來頡自行盤查後進行內部查證，未經第三方機構確信。
範疇二	83.4869			
範疇一與範疇二	91.2767			
		0.1006		

註：密集度以總排放量除以營收百萬元，四捨五入取至小數點第四位。

◆ 組織邊界說明

營運據點別	營運據點說明	盤查	確信	排除
台灣（台北總部、新竹辦公室）	來頡科技股份有限公司	●		
中國大陸	來頡（深圳）半導體有限公司 註 西安來頡半導體有限公司			
美國	M3 Technology (Dallas), Inc.			
排除範圍	說明			
投資控股公司	Blink Electronic Co., Ltd.			

註：截至 2024 年 12 月 31 日止尚未注資。

6-5 數據揭露範疇

來頡科技及旗下子公司	重要營運據點		
	台灣 (含台北與新竹)	中國大陸	美國
來頡科技股份有限公司	●		
Blink Electronic Co., Ltd. ^{1,3}			
M3 Technology (Dallas), Inc. ¹			●
西安來頡半導體有限公司 ¹		●	
來頡 (深圳) 半導體有限公司 ^{1,2}		●	
治理 Governance			
財務績效	●	●	
誠信經營與教育訓練	●		
智慧財產權	●		
供應鏈管理	●	●	
品質管理	●	●	
環境 Environment			
溫室氣體排放	●		
能源管理	●		
水資源管理	● ⁴		
廢棄物管理	●		
社會 Social			
員工人數	●		
教育訓練	●		
薪酬福利	●		
職業安全衛生	●		

註 1：100% 持股子公司。

註 2：截至 2024 年 12 月 31 日止尚未注資。

註 3：屬投資控股公司無實際營運據點。

註 4：台北辦公室水費涵蓋於大樓管理費



M3TEK

來頡科技股份有限公司
M3 Technology Inc.